

旺矽科技股份有限公司

MPI Corporation

113 年度年報

刊印日期：中華民國一一四年五月二十三日

公司網址：<http://www.mpi.com.tw>

本年報查詢網址/公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

一、公司發言人、代理發言人：

發言人姓名：邱靖斐

職稱：董事長特別助理

電話：03-5551771

電子郵件信箱：amanda.chiu@mpi.com.tw

代理發言人姓名：莊潔志

職稱：業務處副處長

電話：03-5551771

電子郵件信箱：raymond.chuang@mpi.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：新竹縣竹北市中和街 151 號、153 號、155 號

電話：03-5551771

竹北二廠：新竹縣竹北市中和街 129 號

電話：03-5551771

竹北三廠：新竹縣竹北市泰和路 155 號

電話：03-5551771

新埔廠：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段 988 號

電話：03-5551771

湖口廠：新竹縣湖口鄉光復路 42 號 B 棟 1F

電話：03-5551771

南部分公司：高雄市路竹區路科一路 7 號

電話：07-9559966

三、股票過戶機構：

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

地址：台北市民生東路四段 54 號 4 樓

網址：<http://www.entrust.com.tw>

電話：02-27186425

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：陳枝凌會計師、陳依玲會計師

事務所名稱：日正聯合會計師事務所

地址：台北市復興北路 33 號 2 樓

網址：<http://nexia.otc.gs>

電話：02-27510306

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：不適用

六、公司網址：<http://www.mpi.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	11
三、公司治理運作情形	15
四、簽證會計師公費資訊	42
五、更換會計師資訊	42
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	42
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形	42
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊	44
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	45
參、募集情形	46
一、資本及股份	46
二、公司債辦理情形	50
三、特別股辦理情形	52
四、海外存託憑證辦理情形	52
五、員工認股權憑證辦理情形	52
六、限制員工權利新股辦理情形	52
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形.....	52
八、資金運用計畫執行情形	53
肆、營運概況	55
一、業務內容	55
二、市場及產銷概況	66
三、從業員工資料	71
四、環保支出資訊	71
五、勞資關係	72
六、資通安全管理	76
七、重要契約	77
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	78
一、財務狀況	78
二、財務績效	79
三、現金流量	79
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	80

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	80
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項：	80
七、其他重要事項	83
陸、特別記載事項	84
一、關係企業相關資料	84
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	89
三、其他必要補充說明事項	89
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	89

壹、致股東報告書

一、一一三年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本集團民國 113 年合併營業收入淨額為新台幣 101.72 億元，較 112 年的 81.47 億元增加 25 %；113 年盈餘為新台幣 23.01 億元，較 112 年盈餘 13.12 億元增加 75%，每股稅後盈餘為 24.42 元。

知名研調機構 IEK 預測，2025 年全球半導體市場產值將高達 6,850 億美元，較去年成長 12.5%。其中，受全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續攀升的帶動，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業應用，各主要市場的技術規格皆不斷升級。半導體供應鏈涵蓋設計、製造、封測及先進封裝等領域，在產業上下游的緊密合作下，將共創新一波成長契機。此外，研調機構進一步預估，2021 至 2026 年全球 AI 半導體市場的年複合成長率（CAGR）將達 19.9%，對應全球半導體市場 CAGR 5.8%，可預見 AI 半導體的強勁成長將成為推動半導體市場發展的主要動力。同時，隨著 AI 晶片需求大幅增加，研調機構預測全球半導體市場規模將在 2027 年達到 7,000 至 8,000 億美元。AI 晶片的蓬勃發展預計將為全球半導體供應鏈帶來龐大的商機。

半導體晶片需要探針卡來協助檢驗產品品質，沒有探針卡的良率把關，晶片無法順利出貨。現今人類的生活高度依賴電子化的產品，越來越多的電子化產品出現在我們的生活中，確立了半導體生產測試的長期成長趨勢。旺矽作為國際知名的探針卡領導廠商，憑藉與全球頂尖 IC 設計大廠的長期合作，建立了堅實的技術基礎。此外，在半導體工程測試與溫度測試等自製設備領域，預期也將隨著 AI 應用的快速發展，市場需求亦將穩步提升。展望未來，旺矽將持續專注於提高自身技術與服務品質，以期為股東創造更高的投資價值。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度		113 年度	112 年度	增(減)%
財務收支	營業收入淨額	10,171,861	8,147,112	24.85
	營業毛利	5,560,970	3,897,063	42.70
	稅後損益	2,301,359	1,311,899	75.42
獲利能力	資產報酬率(%)	16.08	11.40	41.05
	股東權益報酬率(%)	27.17	18.05	50.53
	營業利益占實收資本比率(%)	263.47	156.14	68.74
	稅前純益占實收資本比率(%)	296.58	167.92	76.62
	純益率(%)	22.61	16.07	40.70
	每股盈餘(元)	24.42	13.92	75.43

(三)研究發展狀況

本公司在一一三年度之研發成果包括：

1. 晶圓探針卡：

- 因應 AI 高速運算的市場需求，本公司開發高速測試探針卡，滿足客戶在晶圓量產穩定測試之技術需求。
- 隨著汽車能源由汽油移轉至電能，並對輔助駕駛技術需求的不斷增加，車用 IC 需求與日俱增。為滿足客戶需要，開發大面積高同測，高低溫之探針卡，以因應車用 IC

- 客戶提升產能的產品需求。
- C. 完成開發現階段對應市場最高速需求的探針卡解決方案。
 - D. 對應測試應用，逐步建構探針卡需求矩陣的各針種及解決方案。
 - E. 在多層有機載板方面，本公司不斷投注研發完成更精細的線寬線距；PCB 完成更高層數的多層板開發，強化探針卡整卡的產品競爭力。
2. 半導體光電自動化設備：
- A. Micro LED 微顯示元件之晶圓及測試系統，包含高防震設備開發，以及微米(um)等級發光元件之量測能力。
 - B. 光通訊元件 VCSEL、EEL、DFB 等之光電特性量測設備。
 - C. 矽光子晶粒等級量測設備，可運用於 PIC、EIC+PIC 晶圓切割後的 KGD 製成測試 (Known Good Die process)，包含相關的光電轉換特性量測，以及高頻元件的頻寬與雜訊測試。
 - D. 自動化系統軟體共用平台，簡化程式編碼需求，加快自動化應用開發時程。
3. 半導體元件溫度測試系統系列產品：
- 持續開發不同測試溫度範圍及流量之機種，以滿足客戶多工測試的需求，並搭配客戶系統的客製化整合機，提供量產及工程最適合的對應方案。
4. 半導體工程用檢測機系列產品：
- 在矽光子應用，因應客戶不同電光輸出入位置，成功推出雙向點測檢測機，以符合各客戶多樣的設計佈局。完成高陣列垂直式探針卡的工程用量測平台，大幅增加測試多樣性度。

二、一一四年度營業計畫概要

(一)經營方針

技術是維持競爭力的核心基石，鑒於微電子產業之發展與未來技術需求，本公司秉持協助客戶提昇競爭力的核心理念，進行以下策略規劃與努力，以期與客戶一同成長：

1. 為滿足高階 IC 製程微縮、高階封裝，本公司持續開發晶圓級微間距之新技術。
2. 對應 AI 應用的快速發展，在高速運算之應用需求，本公司持續開發高耐電流之探針及高耐電流整卡架構。
3. 對應客戶高溫及高同測數的需求，本公司持續研發高溫大面積高針數探測的探針卡技術。
4. 在多層有機載板方面，本公司持續精細線寬線距。PCB 亦往更高層數的目標投注開發能量，以滿足客戶更高規格的技术需求。
5. 半導體光電自動化產業，聚焦於光通訊(optical communication, Silicon Photonics)、感測(Sensing & LiDar)、微顯示器(Micro display)、化合物半導體(LED, GaN, SiC...)等四大產業領域，提供在不同溫度環境下的短脈衝、高電壓與高電流的量測、分選、光學檢查等，光、機、電高度整合的自動化設備。並與國際技術領導客戶深化合作，以提供半導體產業下一世代產品，創新量產技術的 Turnkey Solution 為主要發展目標。同時導入生成式 AI 大語言模型 (LLM)，發展自動化系統軟體共用平台，以加速與簡化新應用的設計時程，提升產業自動化的效率。
6. 在元件溫度測試系統方面，將產品線更廣泛佈局，包含實驗室桌下型冷熱加溫系統的開發，以符合客戶量產的最佳配置需求。同時也投注研發能量，開發 IC 接觸式溫控的產品，以對應人工智慧快速發展之應用。並持續拓展及設計不同系列產品，提供市場各種量產或實驗室最佳的對應產品。
7. 在半導體工程檢測應用領域，將著重在更高頻更精準的量測項目，以及持續強化各產品功能，讓客戶在使用產品時，能得到更精準的量測及更便利的操作，加速完成工程實驗。

(二)重要產銷政策

因應生活智慧化、無接觸化、汽車電動化、減碳需求以及 AI 浪潮帶來產業各層面的新興應用市場，本公司密切關注新興科技發展趨勢，訂定技術藍圖，將研發技術快速精確地導入新產品以擴展業務，並持續強化海外據點的支援能力，以期更快速精確的提供客戶完整的技術服務，進而提升產品市占率。

旺矽科技秉持協助客戶提昇競爭力的核心理念，將自身定位為客戶之技術合作夥伴，針對客戶未來的需求共同開發最適切的產品與即時的技術服務為主要產銷政策，為客戶提供最佳的解決方案。

三、未來公司發展策略

- (一) 以點測、分選、光電測試、影像檢測、自動化設備等五大核心技術領域為基礎，提供完整的測試應用解決方案，滿足光電半導體產業的新產品量產需求。並導入生成式 AI 大語言模型(LLM) 應用技術，提升系統自動化程度與效率，加快新應用的開發時程。
- (二) 在半導體工程檢測應用領域，以微小訊號、高頻量測、高功率、高低溫量測的技術領域，對應矽光子的發展，持續精進技術，並以創新的組合，提供矽光子不同階段發展的量測方案，強化產品競爭力。
- (三) 以溫控核心技術，持續開發半導體市場。並計畫將溫度測試系統推展到 AI、車用、高頻通訊、傳感器、數據中心光纖等非電子市場。
- (四) 因應人工智慧的快速發展伴隨著電子產品之體積縮小化，更高速、多功能、高功能、智能化、更省電、更高的環境忍受度等多樣且持續的晶片終端需求，依照訂定的技術開發里程碑(road map)，持續開發大面積、高針數、微間距、高耐電流、高速傳輸、低針壓探針卡、耐高低溫測試的探針卡，滿足市場需求，確保競爭力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

受美中貿易戰、疫後供應鏈等因素影響，半導體產業成為各國政策重心。為維護全球經濟穩定、國家安全以及科技發展，歐美日的友好盟國持續強化相互間的半導體及科技交流合作，盟國間透過投策略佈局形成跨國合作又相互競爭角力的微妙關係。

旺矽為全球第三大非記憶體的探針卡廠商，長期戮力於全球化的佈局。公司已在過去幾年相繼設立美國與全球銷售據點，並持續投注能量提供客戶最佳的服務，各個產品線目前在全球能見度與市佔率都在持續增加中。

完整的半導體測試介面、測試平台、測試環境... 等產品的全球化佈局，能夠讓旺矽為全球客戶提供量身訂做快速、穩定、高品質的解決方案及服務，也讓旺矽能在 2023 年全球經濟衰退時保持穩健經營的能量，至 2024 年經濟緩步成長時，持續有向上的成長力道，展現我們佈局的成效。

相信旺矽的全球化的佈局與晶圓測試產品的完備有助於旺矽維持穩定營運及獲利成長，持續為股東創造長期投資效益。

董事長：葛長林



總經理：郭遠明



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事：

董 事 資 料(一)

114 年 4 月 30 日 單位：股；%

職 稱	國籍或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任 期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	旺矽投資 (股)公司	-	112.06.15	3 年	90.04.16	8,334,626	10.42%	8,334,626	8.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
		代表人-- 葛長林	男 61~70 歲	112.06.15	3 年	105.07.11	1,425,994	1.78%	1,425,994	1.51%	427,781	0.45%	0	0.00%	學歷：交通大學管理 學院 EMBA 經歷：工研院電子 所	本公司：董事長 他公司：長洛國際(股)公司董事 長、旺矽投資(股)公司董事長、 MMI HOLDING CORP. 董事長、MPI TRADING CORP. 董事長、MPA TRADING CORP. 董事長、吉比 鮮釀(股)公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	旺矽投資 (股)公司	-	112.06.15	3 年	90.04.16	8,334,626	10.42%	8,334,626	8.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
		代表人-- 陳四桂	男 61~70 歲	112.06.15	3 年	101.08.01	230,283	0.29%	230,283	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：台灣大學機械 研究所 經歷：工研院材料 所	本公司：顧問 他公司：長洛國際(股)公司董 事、旺矽投資(股)公司董事、均 揚電子(股)公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	旺矽投資 (股)公司	-	112.06.15	3 年	90.04.16	8,334,626	10.42%	8,334,626	8.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
		代表人-- 郭遠明	男 61~70 歲	112.06.15	3 年	101.11.26	438,037	0.55%	392,037	0.42%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：南佛羅里達大 學電機研究所 經歷：工研院機械 所	本公司：總經理 他公司：長洛國際(股)公司董 事、旺矽投資(股)公司監察人、 均揚電子(股)公司董事長、疏明 光電(常州)有限公司董事長	無	無	無	無

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶 或二親 等以內 關係之 其他主 管、董事 或監察 人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中 華 民 國	李篤誠	男 51~60 歲	112.06.15	3 年	90.04.16	599,349	0.75%	409,349	0.43%	414	0.00%	0	0.00%	學歷：逢甲大學企管系 經歷：長洛國際(股)公司	本公司：無 他公司：博磊科技(股)公司董事長、晨和投資有限公司董事長、贊鴻實業(股)公司董事長、博磊精密設備(蘇州)有限公司董事、Zen Voce(Pg)Sdn. Bhd 董事長、Zen Voce Manufacturing Pte Ltd. 董事長	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	劉方勝	男 61~70 歲	112.06.15	3 年	90.04.16	255,471	0.32%	255,471	0.27%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：高雄醫學院牙醫系 經歷：台北市仁愛醫院	本公司：無 他公司：立誠牙科診所醫師	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	蔡長壽	男 61~70 歲	112.06.15	3 年	92.06.20	21,630	0.03%	21,630	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：文化大學會計系 經歷：台灣省政府主計處	本公司：無 他公司：勤信聯合會計師事務所執業會計師、廣隆光電科技(股)公司董事	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	許梅芳	女 51~60 歲	112.06.15	3 年	90.04.16	244,441	0.31%	133,441	0.14%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：銘傳大學會計系 經歷：正風聯合會計師事務所	本公司：無 他公司：大亞聯合會計師事務所執業會計師	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	高進振	男 61~70 歲	112.06.15	3 年	90.04.16	162,414	0.20%	160,414	0.17%	17,944	0.02%	0	0.00%	學歷：中興大學法律研究所 經歷：慧林法律事務所	本公司：無 他公司：高進振律師事務所主持律師、數泓科技(股)公司獨立董事、薪酬會委員及審計委員會委員	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	廖大穎	男 61~70 歲	112.06.15	3 年	109.06.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：日本神戶大學法學博士 經歷：中興大學法律系教授	本公司：無 他公司：東海大學法律學院教授、通用幹細胞(股)公司獨立董事、薪酬會委員及審計委員會委員	無	無	無	無

(二)董事屬法人股東代表者，該法人股東之主要股東：

114 年 4 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
旺矽投資股份有限公司	葛長林	44.83%
	李篤誠	27.17%
	陳四桂	9.06%
	蔡淑錦	6.34%
	謝偉允	3.60%
	郭遠明	2.68%
	葛永綸	2.44%
	葛郁沛	2.36%
	葛郁笙	1.52%

(三)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

(1)董事專業資格與經驗

姓名		專業資格與經驗
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人—葛長林	畢業於交通大學管理學院 EMBA 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任本公司之董事長，擁有產業相關專業之領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向企業永續經營。
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--陳四桂	畢業於台灣大學機械研究所 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任本公司之顧問，專精於半導體相關領域之研究及創新，對公司產品研發及產品應用開發提供專業之經驗。
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--郭遠明	畢業於南佛羅里達大學電機研究所 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任本公司總經理，專精於公司營運管理，對生產管理及規劃、市場策略與業務拓展提供專業之經驗。
董事	劉方勝	畢業於高雄醫學院牙醫系 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任立誠牙科診所醫師，具有經營管理專業及公司治理專才經驗，能為公司營運發展提供重要建言，給與董事會適時監督及專業意見。
董事	李篤誠	畢業於逢甲大學企管系 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任博磊科技股份有限公司董事長，具有產業及企業管理等專業領域之工作經驗及公司治理專才經驗，藉由其專長使其給與董事會適時監督並提供專業意見。
董事	蔡長壽	畢業於文化大學會計系 具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上會計師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任勤信聯合會計師執業會計師，具備財務會計專業資格能力及熟悉相關法令規定，能對公司提出具體建議，可發揮其專長及給予董事會監督並提供意見。
獨立 董事	許梅芳	畢業於銘傳大學會計系 具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上會計師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任大亞聯合會計師事務所執業會計師，具備專業背景並熟稔財會相關法規，能適時以專業客觀立場，提供本公司必要的監督與建議。

獨立董事	高進振	畢業於中興大學法律研究所 具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上律師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任高進振律師事務所主持律師，具有法律專業並精通相關法令，於董事會及公司治理方面提供法律見解，公司經營決策之適法性及降低可能違反法令規定之風險。
獨立董事	廖大穎	畢業於日本神戶大學法學博士 具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上法務或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授之專業資格。 現任東海大學法律學院教授，法學方面具有深厚的學養，學術界地位崇高，熟稔公司治理，能提供董事會重要的法律知識及公司治理見解，對本公司助益良多。

(2)董事獨立性資訊

姓 名		獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人—葛長林	不適用	無
董事	旺矽投資(股)公司 代表人—陳四桂		無
董事	旺矽投資(股)公司 代表人—郭遠明		無
董事	劉方勝	於選任前兩年及任職期間，皆已符合下述各獨立性評估條件： (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
董事	李篤誠	(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
董事	蔡長壽	(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
獨立董事	許梅芳	(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或 配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
獨立董事	高進振	(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人或持股 5%以上股東 (但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計 金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相 關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人及其配偶。	1
獨立董事	廖大穎	但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會成員多元化政策：

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別及年齡等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司現任董事會由9位董事組成，其中包含3位獨立董事，每位董事皆具備包括法律、財務會計、產業知識、領導決策及經營管理等專業背景。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以三分之一女性董事席次為目標，未來將朝增加女性董事席次，以達成目標。

- 具員工身份之董事佔比為22%、獨立董事佔比為33%。
- 女性董事佔比為11%、男性董事佔比為89%。
- 1位獨立董事任期年資在3年至9年、2位獨立董事任期年資9年以上。
- 7位董事年齡在61至70歲、2位董事年齡在51至60歲。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：

多元化 核心項目 董事會 成員	國籍	性別	兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資			年齡		經營 管理 及 營業 判斷	財務 及 會計	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 與 決策
				3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上	51 到 60	61 到 70						
葛長林	中華民國	男						✓	✓		✓	✓	✓	✓
陳四桂	中華民國	男	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓
郭遠明	中華民國	男	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓
劉方勝	中華民國	男						✓	✓		✓	✓	✓	✓
蔡長壽	中華民國	男						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李篤誠	中華民國	男					✓		✓		✓	✓	✓	✓

許 梅 芳	中華民國	女				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
高 進 振	中華民國	男				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
廖 大 穎	中華民國	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少包含一名女性董事	已達成
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

(二)董事會獨立性：

(1)本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事成員，獨立董事佔比為 33%。

(2)本公司所有董事會成員間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第 6-9 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事資料(請參閱本年報第 4-5 頁-董事資料)。

(四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114年4月30日 單位：股；%

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	郭遠明	男	99.06.15	392,037	0.42%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：南佛羅里達大學 電機研究所 經歷：工研院機械所	長洛國際(股)公司董事 旺矽投資(股)公司監察人 均揚電子(股)公司董事長 琉明光電(常州)有限公司董事長	無	無	無	無
設備營運中心 副總經理	中華民國	范維如	男	97.07.01	75,034	0.08%	244	0.00%	0	0.00%	學歷：交通大學控制工程研究所 經歷：工研院機械所	無	無	無	無	無
市場行銷 副總經理	中華民國	劉永欽	男	100.06.20	9,211	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：成大航太工程系 博士 經歷：工研院機械所	均揚電子(股)公司董事	無	無	無	無
財務主管 公司治理主管	中華民國	湯復評	男	108.05.07	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：中正大學財務金融所博士 經歷：正達國際光電股份有限公司	無	無	無	無	無
會計主管	中華民國	饒雲珍	女	96.03.09	47,251	0.05%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：明新科技大學企業管理系 經歷：崇越石英製造廠(股)公司	長洛國際(股)公司監察人 均揚電子(股)公司監察人 琉明光電(常州)有限公司監察人 旺矽科技(蘇州)有限公司監察人	無	無	無	無
南區製造處 副處長	中華民國	汪建明	男	105.11.14	4,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：南亞工專機械科 經歷：尹嘉工業	無	無	無	無	無
資安主管	中華民國	范文城	男	112.03.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：雪菲爾大學資訊管理研究所 經歷：台灣應用材料股份有限公司	無	無	無	無	無

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金：

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額 及占稅後純益之 比例		領取 來自 子公司 以外轉 投資 事業 或母公 司酬金
		報酬(A)		退職退 休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司			
董事長	旺矽投資股份 有限公司代表 人：葛長林	0	0	0	0	41,571	41,571	0	0	41,571 1.81%	41,571 1.81%	29,908	29,908	216	216	1,360	0	1,360	0	73,055 3.17%	73,055 3.17%	無
董事	旺矽投資股份 有限公司代表 人：陳四桂																					
董事	旺矽投資股份 有限公司代表 人：郭遠明																					
董事	李篤誠																					
董事	劉方勝																					
董事	蔡長壽																					
獨立董事	許梅芳	0	0	0	0	20,786	20,786	0	0	20,786 0.90%	20,786 0.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786 0.90%	20,786 0.90%	無
獨立董事	高進根																					
獨立董事	廖大穎																					
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事之報酬由薪資報酬委員會依公司章程之規定，審議各獨立董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準發放情形，並提交至董事會討論決議。 2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。 3. 退職退休金係為本公司提列提撥數。																						

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)				
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)				
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)				
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明 李篤誠、劉方勝、蔡長壽	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明 李篤誠、劉方勝、蔡長壽	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 李篤誠、劉方勝、蔡長壽	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 李篤誠、劉方勝、蔡長壽
	獨立董事:許梅芳、高進根、廖大穎	獨立董事:許梅芳、高進根、廖大穎	獨立董事:許梅芳、高進根、廖大穎	獨立董事:許梅芳、高進根、廖大穎
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)				
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)			一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)				
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)				
100,000,000 元以上				
總 計	9 人	9 人	9 人	9 人

(二)總經理及副總經理之酬金：

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例(%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或母 公司酬金
		本公司	財務報告 內所有公司	本公司 (註 1)	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報告 內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	郭遠明	8,196	8,196	322	322	8,256	8,256	743	0	743	0	17,517 0.76%	17,517 0.76%	無
副總經理	范維如													
副總經理	劉永欽													

註：退職退休金係為本公司提列提撥數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司(E)
低於1,000,000元		
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	范維如、劉永欽	范維如、劉永欽
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)		
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)		
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	郭遠明	郭遠明
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)		
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總 計	3人	3人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	郭遠明	0	1,464	1,464	0.06%
	副總經理	范維如				
	副總經理	劉永欽				
	財務主管	湯復評				
	公司治理主管					
	會計主管	饒雲珍				
	分公司經理	汪建明				
資安主管	范文城					

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

單位：新台幣仟元

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	112 年度		113 年度		112 年度		113 年度	
	總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例
董事酬金	55,816	4.25%	93,841	4.08%	55,816	4.25%	93,841	4.08%
總經理及副總經理酬金	13,814	1.05%	17,517	0.76%	13,814	1.05%	17,517	0.76%
稅後純益	1,311,899	-	2,301,359	-	1,311,899	-	2,301,359	-

說明：113年度董事之酬金總額較112年度增加，係因113年稅前獲利增加，致提撥董事酬金也增加。

1. 本公司對於董事酬金之發放，依公司章程中訂定提撥，本公司年度如有稅前獲利，應提撥不高於百分之三作為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞，並經薪資報酬委員會及董事會審議通過後，提請股東會核准。
2. 本公司總經理及副總經理之委任、解任及報酬依公司規定辦理發放，並隨著經營績效之表現作適當調整，經薪資報酬委員會審議通過後，再提請董事會通過後完執行，本公司酬金政策係與盈餘相關，與未來風險無相關性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

113 年度董事會開會 6 次(A)董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出 席次數	實際出(列) 席(%) (B/A)	備註
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人—葛長林	4	2	67%	
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--陳四桂	6	0	100%	
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--郭遠明	6	0	100%	
董事	李 篤 誠	5	1	83%	
董事	劉 方 勝	5	1	83%	
董事	蔡 長 壽	6	0	100%	
獨立董事	高進根	6	0	100%	
獨立董事	許梅芳	6	0	100%	
獨立董事	廖大穎	6	0	100%	

113 年度各次董事會獨立董事出席狀況

◎：親自出席；☆：委託出席；*：未出席

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次
高進根	◎	◎	◎	◎	◎	◎
許梅芳	◎	◎	◎	◎	◎	◎
廖大穎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參酌第 40 頁至第 41 頁董事會重要決議。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：請參酌第 40 頁至第 41 頁董事會重要決議。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：不適用。

三、本公司董事會、董事成員、審計委員會、薪酬委員會自我評鑑之執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評 估 內 容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	董事會	董事會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	董事成員	董事成員 內部自評	1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。

				5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	審計委員會	審計委員會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 審計委員會職責認知。 3. 提升審計委員會決策品質。 4. 審計委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	薪酬委員會	薪酬委員會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 薪酬委員會職責認知。 3. 提升薪酬委員會決策品質。 4. 薪酬委員會組成及成員選任。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- （一）本公司依照「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於公司網站揭露董事會重要決議事項。
- （二）本公司於100年12月30日成立薪資報酬委員會，日後係以專業客觀評估本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度，並向董事會提出建議，作為決策之參考。
- （三）本公司於109年6月15日起設立審計委員會，由3名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司風險之管控評估。

（二）審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

1. 財務報表。
2. 稽核及會計政策與程序。
3. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 重大資金貸與背書或保證。
6. 募集或發行有價證券。
7. 衍生性金融商品及現金投資情形。
8. 法規遵循。
9. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
10. 申訴報告。
11. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告。
12. 資訊安全。
13. 公司風險管理。
14. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。
15. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
16. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
17. 審計委員會職責履行情形。
18. 審計委員會績效評量自評問卷。

審閱財務報告

董事會造具本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託日正聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構(Internal Control-Integrated Framework)，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

113 年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事 (召集人)	許梅芳	6	0	100%	
獨立董事	高進振	6	0	100%	
獨立董事	廖大穎	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

董事會 日期	審計委員會 日期	議案內容及 後續處理	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
第 10 屆 第 5 次 113/01/31	第 2 屆 第 5 次 113/01/31	無討論事項	不適用	不適用
第 10 屆 第 6 次 113/03/07	第 2 屆 第 6 次 113/03/07	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 評估 113 年度簽證會計師獨立性及適任性案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		4. 修訂本公司「董事會議事規範」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		5. 修訂「審計委員會組織規程」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		6. 修訂「銷貨及收款循環」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		7. 112 年度內部控制制度聲明書之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		8. 本公司自地委建廠房工程之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		9. 本公司擬繼續處分韓國子公司股權案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 7 次 113/05/08	第 2 屆 第 7 次 113/05/08	1. 本公司 113 年第一季財務報告案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 本公司自地委建廠房工程案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 8 次	第 2 屆 第 8 次	1. 本公司 113 年第三季財務報告案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過

113/08/13	113/08/13			
第 10 屆 第 9 次 113/09/23	第 2 屆 第 9 次 113/9/23	1. 本公司核決權限表修訂案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 本公司取得機器設備案及廠務工程案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 本公司擬收購股權案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 10 次 113/11/12	第 2 屆 第 10 次 113/11/12	1. 本公司 113 年第三季財務報告案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 增訂本公司「永續資訊之管理辦法」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 增訂本公司「永續報告書編製及查證作業辦法」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		4. 修訂本公司「MIS 循環架構」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		5. 本公司 114 年度內部稽核計劃之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		6. 本公司 114 年度內部稽核計劃之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)本公司定期召開審計委員會並視需要邀請簽證會計師、財務主管、會計主管、內部稽核主管及相關主管列席。

(二)內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

(三)審計委員會每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」，並已於本公司網站與公開資訊觀測站揭露相關內容。	無差異
二、公司股權結構及股東權益				

評估項目	運作情形			與上市 上櫃公 司治理 實務守 則差異 情形及 原因															
	是	否	摘要說明																
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司已制定股東會議事規則，並依規定建立發言人與代理發言人制度，設置專人處理投資人關係與股東相關問題，公司網站亦設有投資人專區之處理窗口聯絡電話與 E-mail。	無差異															
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司委由股務代理機構，並定期更新股東名冊，以掌控公司股權最終控制者之名單。	無差異															
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		對關係企業間建立「子公司監理辦法」、「特定公司集團企業及關係人交易管理辦法」等控管制度。	無差異															
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已訂定「防範內線交易管理」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，本公司 113 年召開 6 次董事會，並通知董事、經理人開會日期以及各季財務報告之提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日 and 每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事及內部人誤觸該規定。	無差異															
三、董事會之組成及職責																			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		董事會成員落實多元化政策、具體管理目標及落實執行請參閱本年報第 8 至第 9 頁。	無差異															
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司尚未設置其他各類功能性委員會。	無差異															
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司 109 年 1 月 14 日董事會決議通過訂定「董事會自我評鑑辦法」其評估的方式為成員自評，113 年度董事會績效考核、董事會成員績效考核、審計委員會績效考核、薪酬委員會績效考核等自評評估已於 114 年 3 月 12 日向董事會報告。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>評估範圍</th><th>董事會 績效考 核</th><th>董事會 成員績 效考核</th><th>審計委 員會績 效考核</th><th>薪酬委 員會績 效考核</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自評指標</td><td>23 項</td><td>16 項</td><td>16 項</td><td>12 項</td></tr> <tr> <td>評分結果</td><td>4.99 分</td><td>4.96 分</td><td>5.00 分</td><td>4.90 分</td></tr> </tbody> </table> 註：自評指標及等級：1 非常不滿意；2 不滿意；3 普通；4 滿意；5 非常滿意。	評估範圍	董事會 績效考 核	董事會 成員績 效考核	審計委 員會績 效考核	薪酬委 員會績 效考核	自評指標	23 項	16 項	16 項	12 項	評分結果	4.99 分	4.96 分	5.00 分	4.90 分	無差異
評估範圍	董事會 績效考 核	董事會 成員績 效考核	審計委 員會績 效考核	薪酬委 員會績 效考核															
自評指標	23 項	16 項	16 項	12 項															
評分結果	4.99 分	4.96 分	5.00 分	4.90 分															

評估項目	運作情形			與上市 上櫃公 司治理 實務守 則差異 情形及 原因																				
	是	否	摘要說明																					
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經 114 年 3 月 12 日審計委員會決議通過後，並提報 114 年 3 月 12 日董事會決議通過。 本公司會計師獨立性評估標準如下： <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th></tr><tr><td>委任會計師與本公司並無有投資或分享財務利益之關係。</td><td>是</td></tr><tr><td>委任會計師本人並無與本公司有資金借貸之情事。</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。</td><td>是</td></tr><tr><td>委任會計師最近二年內並無擔任本公司有重大影響之職務。</td><td>是</td></tr><tr><td>對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。</td><td>是</td></tr><tr><td>委任會計師或審計服務小組成員並無握有本公司所發行之股票或其他證券。</td><td>是</td></tr><tr><td>委任會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人有重大影響職務之人員有親屬關係。</td><td>是</td></tr><tr><td>委任會計師並無擔任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。</td><td>是</td></tr><tr><td>委任會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。</td><td>是</td></tr></table>	評估項目	評估結果	委任會計師與本公司並無有投資或分享財務利益之關係。	是	委任會計師本人並無與本公司有資金借貸之情事。	是	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	是	委任會計師最近二年內並無擔任本公司有重大影響之職務。	是	對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	是	委任會計師或審計服務小組成員並無握有本公司所發行之股票或其他證券。	是	委任會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人有重大影響職務之人員有親屬關係。	是	委任會計師並無擔任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。	是	委任會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是	無差異
評估項目	評估結果																							
委任會計師與本公司並無有投資或分享財務利益之關係。	是																							
委任會計師本人並無與本公司有資金借貸之情事。	是																							
會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	是																							
委任會計師最近二年內並無擔任本公司有重大影響之職務。	是																							
對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	是																							
委任會計師或審計服務小組成員並無握有本公司所發行之股票或其他證券。	是																							
委任會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人有重大影響職務之人員有親屬關係。	是																							
委任會計師並無擔任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。	是																							
委任會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是																							

評估項目	運作情形			與上市 上櫃公 司治理 實務守 則差異 情形及 原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		本公司之公司治理主管負責公司治理相關事務，業經 112 年 3 月 10 日董事會通過設置，前項公司治理相關事務，至少應包括以下內容： (1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (2)製作董事會及股東會議事錄。 (3)協助董事就任及持續進修。 (4)提供董事執行業務所需之資料。 (5)協助董事遵循法令。 (6)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (7)辦理董事異動相關事宜。 (8)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 113 年度本公司公司治理業務執行情形： (1)113 年度完成召開 6 次董事會、6 次審計委員會、3 次薪資報酬委員會。 (2)113 年度召開 1 次股東常會。 (3)113 年度安排董事進修 6 小時課程。 (4)辦理董事會暨功能性委員會自行評估，並將績效評估結果於 114 年 3 月 12 日董事會報告。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	✓		本公司已於公司網站建立與利害關係人溝通專區。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司已委任專業股務代辦機構華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	✓		本公司股票代號為 6223，可透過公開資訊觀測站瞭解本公司財務業務及公司治理資訊之情形，本公司另設立網址： http://www.mpi.com.tw	無差異

評估項目	運作情形			與上市 上櫃公 司治理 實務守 則差異 情形及 原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓		本公司設立之自有網址亦有英文說明，並指定發言人或代理發言人負責公司資訊之蒐集及揭露，以落實發言人制度。	無差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限內公告申報。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		(1)本公司依循法令規章制定工作規則，將人權及員工權益之保障明文規範在內，而對於往來之廠商、客戶皆保持互助合作之良好關係。 (2)本公司已設立公司治理實務守則，並執行相關運作情形。 (3)本公司董事均能本於忠實執行業務並盡善良管理人之義務行使職權。 (4)本公司依『上市上櫃公司治理實務守則』規範，已為董事購買責任保險，相關資訊請於公開資訊觀測站查詢。 (5)為強化公司治理，本公司董事會會議每季至少召開一次。 (6)董事進修之情形已揭露於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)	無差異
九、請就台灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善提出優先加強事項與措施:本公司在各方面將不斷展現永續經營實力，亦將持續秉持誠信經營的企業社會責任，肩負對各利害關係人與社會之長期永續責任。				

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 30 日

條件 身份別 (註 1)	姓名	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
--------------------	----	--------------	------------	-----------------------------------

獨立董事 (召集人)	高進根	請參閱本年報第 4-5 頁，董事資料 (一)相關內容	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	1
獨立董事	許梅芳	請參閱本年報第 4-5 頁，董事資料 (一)相關內容	(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。	無
其他	蘇顯騰	畢業於成功大學法學博士 具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上律師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任慧林法律事務所主持律師，具有法律專業並精通相關法令，於董事會及公司治理方面提供法律見解，公司經營決策之適法性及降低可能違反法令規定之風險。	(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	無

2. 薪資報酬委員會之職責

以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 15 日至 115 年 6 月 14 日，113 年度共開會 3 次(A)。

委員資格及出席情形如下：

職稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備 註
獨立董事 (召集人)	高進根	3	0	100%	
獨立董事 委 員	許梅芳	3	0	100%	

其他 委 員	蘇顯騰	3	0	100%	
董事會 日期	薪資報酬 委員會日期	議案內容及 後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員 會意見之處理	
第 10 屆 第 5 次 113/01/31	第 6 屆 第 3 次 113/01/31	核准 113 年度經理人之薪 資報酬項目案	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席 董事同意通過	
第 10 屆 第 6 次 113/03/07	第 6 屆 第 4 次 113/03/07	核准 112 年度董事及員工 之酬勞分配案	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席 董事同意通過	
第 10 屆 第 8 次 113/08/13	第 6 屆 第 5 次 113/08/13	發放 112 年度經理人之員 工酬勞討論案	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席 董事同意通過	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(3)薪資報酬委員會職權範圍：

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：

- ① 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- ② 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- ③ 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

4. 公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊

- (1)本公司依循法令規章制定工作規則，將人權及員工權益之保障明文規範在內，而對於往來之廠商、客戶皆保持互助合作之良好關係。
- (2)本公司已設立公司治理實務守則，並執行相關運作情形。
- (3)本公司董事均能本於忠實執行業務並盡善良管理人之義務行使職權。
- (4)本公司依『上市上櫃公司治理實務守則』規範，已為董事購買責任保險，相關資訊請於公開資訊觀測站查詢。
- (5)為強化公司治理，本公司董事會會議每季至少召開一次。
- (6)董事進修之情形已揭露於公開資訊觀測站(<http://newmops.tse.com.tw>)

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市 上櫃公 司永續 發展實 務守則 差異情 形及原 因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		- 旺矽科技遵循「上市櫃公司永續發展行動方案」制定《企業永續發展政策》，於民國(下同)111年起成立「ESG 永續委員會」，由總經理擔任主席，並與多位不同領域與事業群之高階主管共同檢視公司永續發展相關核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。 「ESG 永續委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每季會議及依議題而設的公司治理組、安環能發展組、員工事務暨社會參與組、供應鏈管理組、客戶服務組、產品研發暨製程永續組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與方針，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 「ESG 永續委員會」每季召開會議，並向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃。113 年 ESG 永續委員會議題內容包含： 「ESG 年度企劃與法遵趨勢因應」； 「永續發展風險管理與追蹤」、「利害關係人調查情形」； 「重大主題管理」、「永續報告書審核」。 - 同時董事會分別於 113 年 8 月 13 日及 114 年 3 月 12 日由 ESG 永續委員會團隊報告，議案項目如下，受董事會監督與認可並准予持續執行： 「永續發展推動情形報告」。 「113 年度永續發展推動情形及利害關係人溝通情形報告」。	無差異

推動項目	執行情形			與上市 上櫃公 司永續 發展實 務守則 差異情 形及原 因																										
	是	否	摘要說明																											
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1. 本揭露資料涵蓋公司於 113 年 1 月至 113 年 12 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含臺灣既有據點。 2. ESG 永續委員會依據 GRI 重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>策略說明</th></tr><tr><td rowspan="2">環境</td><td>綠色產品</td><td>進行 QC 080000 有害物質管理制度導入評估，首年針對包裝材進行再生物料盤點</td></tr><tr><td>溫室氣體</td><td>擴大至合併公司溫室氣體盤查，並展開中長期減碳專案。</td></tr><tr><td rowspan="3">社會</td><td>產品責任</td><td>客訴流程標準化，並確保符合 ISO 9001 品質管理要求</td></tr><tr><td>職場福利</td><td>提撥每年盈餘持續提高職場福利</td></tr><tr><td>職業安全</td><td>確保符合 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，並針對重大風險事項持續改善</td></tr><tr><td rowspan="5">治理</td><td>品質管理</td><td>將 ISO 9001 品質管理審查納入 ESG 永續委員會進行報告與審查，提高品質管理掌握度</td></tr><tr><td>經營績效</td><td>持續挹注研發資金與強化專利保護，確保產品競爭性</td></tr><tr><td>營運持續</td><td>確保符合 ISO 22301 營運持續管理系統，減少客戶營運中斷機率與發生嚴重性</td></tr><tr><td>供應鏈管理</td><td>加強供應鏈營運不中斷管理，以 RBA 與品質標準進行供應商管理</td></tr><tr><td>法令遵循</td><td>由專責部門定期監控法令遵循，確保公司營運合規性</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	策略說明	環境	綠色產品	進行 QC 080000 有害物質管理制度導入評估，首年針對包裝材進行再生物料盤點	溫室氣體	擴大至合併公司溫室氣體盤查，並展開中長期減碳專案。	社會	產品責任	客訴流程標準化，並確保符合 ISO 9001 品質管理要求	職場福利	提撥每年盈餘持續提高職場福利	職業安全	確保符合 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，並針對重大風險事項持續改善	治理	品質管理	將 ISO 9001 品質管理審查納入 ESG 永續委員會進行報告與審查，提高品質管理掌握度	經營績效	持續挹注研發資金與強化專利保護，確保產品競爭性	營運持續	確保符合 ISO 22301 營運持續管理系統，減少客戶營運中斷機率與發生嚴重性	供應鏈管理	加強供應鏈營運不中斷管理，以 RBA 與品質標準進行供應商管理	法令遵循	由專責部門定期監控法令遵循，確保公司營運合規性	無差異
重大議題	風險評估項目	策略說明																												
環境	綠色產品	進行 QC 080000 有害物質管理制度導入評估，首年針對包裝材進行再生物料盤點																												
	溫室氣體	擴大至合併公司溫室氣體盤查，並展開中長期減碳專案。																												
社會	產品責任	客訴流程標準化，並確保符合 ISO 9001 品質管理要求																												
	職場福利	提撥每年盈餘持續提高職場福利																												
	職業安全	確保符合 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，並針對重大風險事項持續改善																												
治理	品質管理	將 ISO 9001 品質管理審查納入 ESG 永續委員會進行報告與審查，提高品質管理掌握度																												
	經營績效	持續挹注研發資金與強化專利保護，確保產品競爭性																												
	營運持續	確保符合 ISO 22301 營運持續管理系統，減少客戶營運中斷機率與發生嚴重性																												
	供應鏈管理	加強供應鏈營運不中斷管理，以 RBA 與品質標準進行供應商管理																												
	法令遵循	由專責部門定期監控法令遵循，確保公司營運合規性																												
三、環境議題																														
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		1. 持續精進法令遵循內控制度，遵循環保工安法令規定，辦理環境管理相關事務。 2. 通過環境管理系統(ISO 14001)驗證，有效期限為 2022 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 19 日，2025 年度將進行三年重新驗證，最新證書效期預計為 2025 年 09 月 20 日至 2028 年 09 月 19 日。透過系統運作，檢視各流程對環境之影響，進而檢討及持續改善。	無差異																										

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																														
	是	否	摘要說明																															
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		1. 依循國內環保標準，以及貿易當地國有關環保標準，包含 RoHS、無鹵素規範等。並持續辦理各種資材回收再利用、製程原物料與包材採用低污染材料、再生物料，以降低環境負荷之衝擊。 2. 積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。透過 ISO 50001 能源管理系統導入並定期監控評估，提升能源使用效率，近三年(111-113)節能總度數已達到 萬度電。	無差異																														
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		有關氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，列示於本年報附表二之二之三。	無差異																														
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		1. 溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報附表二之二之三。 2. 用水量(涵蓋範圍；母公司全廠區)，通過 ISO 14001 環境管理系統驗證 <table><tr><td></td><td>112 年(m³)</td><td>113 年(m³)</td></tr><tr><td>新竹各廠</td><td>152,050.42</td><td>172,910.32</td></tr><tr><td>高雄廠區</td><td>11,578.99</td><td>15,078.23</td></tr><tr><td>總計</td><td>163,629.41</td><td>187,988.55</td></tr><tr><td>密集度(註)</td><td>24.26</td><td>18.48</td></tr></table> 註：密集度= m³/當年母公司百萬元營收 3. 廢棄物量(涵蓋範圍；母公司全廠區)，通過 ISO 14001 環境管理系統驗證 <table><tr><td></td><td>112 年(Ton)</td><td>113 年(Ton)</td></tr><tr><td>一般事業廢棄物</td><td>473.35</td><td>278.48</td></tr><tr><td>有害事業廢棄物</td><td>21.78</td><td>23.54</td></tr><tr><td>總計</td><td>495.13</td><td>302.02</td></tr><tr><td>密集度(註)</td><td>0.05</td><td>0.03</td></tr></table> 註：密集度= Ton /當年母公司百萬元營收 4. 依循 ISO 14001、50001 環境與能源管理系統，持續針對事業廢棄物、用水與能源進行有效控制與檢量規劃，詳請見 https://www.mpi.com.tw/esg/#environment		112 年(m³)	113 年(m³)	新竹各廠	152,050.42	172,910.32	高雄廠區	11,578.99	15,078.23	總計	163,629.41	187,988.55	密集度(註)	24.26	18.48		112 年(Ton)	113 年(Ton)	一般事業廢棄物	473.35	278.48	有害事業廢棄物	21.78	23.54	總計	495.13	302.02	密集度(註)	0.05	0.03	無差異
	112 年(m³)	113 年(m³)																																
新竹各廠	152,050.42	172,910.32																																
高雄廠區	11,578.99	15,078.23																																
總計	163,629.41	187,988.55																																
密集度(註)	24.26	18.48																																
	112 年(Ton)	113 年(Ton)																																
一般事業廢棄物	473.35	278.48																																
有害事業廢棄物	21.78	23.54																																
總計	495.13	302.02																																
密集度(註)	0.05	0.03																																

四、社會議題

四、社會議題

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		公司依據勞基法第七十條條，訂定工作規則，報請主管機關核備並公開揭示。	無差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司員工福利措施與實施情形，詳請參閱本年報（第 72~75 頁）	無差異

推動項目	執行情形				與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																																		
	是	否	摘要說明																																																																				
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		1. 本公司已通過 ISO45001 職業安全衛生驗證，有限期限為 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，2025 年度將進行三年重新驗證，最新證書效期預計為 2025 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日。 2. 本公司定期辦理作業環境測定、員工健康檢查、健康講座、安全衛生教育訓練、醫師駐點健康諮詢等活動；設置集乳室、醫務室、員工休息室、準媽媽車位等關懷設施，以提供一個安全舒適及員工樂於工作之環境。 公司近二年人員職業安全衛生教育訓練： <table><tr><th rowspan="2">訓練項目</th><th colspan="2">2023 年</th><th colspan="2">2024 年</th></tr><tr><th>次數</th><th>人數</th><th>次數</th><th>人數</th></tr><tr><td>新進人員職業安全衛生教育訓練</td><td>59</td><td>163</td><td>64</td><td>314</td></tr><tr><td>在職人員職業安全衛生教育訓練</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>1,674</td></tr><tr><td>職業安全衛生管理人員教育訓練</td><td>10</td><td>10</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>有害作業主管教育訓練</td><td>30</td><td>30</td><td>17</td><td>17</td></tr></table> 註：在職人員職業安全衛生教育訓練每兩年一次 <table><tr><th>年度</th><th colspan="2">員工失能傷害</th><th>承攬商失能傷害</th><th>重大職災</th><th>職災比率</th></tr><tr><td>2023</td><td>1 件</td><td>1 人</td><td>0</td><td>0</td><td>0.06%</td></tr><tr><td>2024</td><td>2 件</td><td>2 人</td><td>0</td><td>0</td><td>0.11%</td></tr></table> 註：職災比率=員工人數/員工總人數 <table><tr><th>年度</th><th>火災演練</th><th>毒災演練</th><th>火災件數</th><th>死傷人數</th><th>死傷比率</th></tr><tr><td>2023</td><td>2 次</td><td>1 次</td><td>0 件</td><td>0 人</td><td>0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>2 次</td><td>0 次</td><td>0 件</td><td>0 人</td><td>0%</td></tr></table> 註：毒災演練每兩年一次			訓練項目	2023 年		2024 年		次數	人數	次數	人數	新進人員職業安全衛生教育訓練	59	163	64	314	在職人員職業安全衛生教育訓練	0	0	2	1,674	職業安全衛生管理人員教育訓練	10	10	7	7	有害作業主管教育訓練	30	30	17	17	年度	員工失能傷害		承攬商失能傷害	重大職災	職災比率	2023	1 件	1 人	0	0	0.06%	2024	2 件	2 人	0	0	0.11%	年度	火災演練	毒災演練	火災件數	死傷人數	死傷比率	2023	2 次	1 次	0 件	0 人	0%	2024	2 次	0 次	0 件	0 人	0%	無差異
訓練項目	2023 年		2024 年																																																																				
	次數	人數	次數	人數																																																																			
新進人員職業安全衛生教育訓練	59	163	64	314																																																																			
在職人員職業安全衛生教育訓練	0	0	2	1,674																																																																			
職業安全衛生管理人員教育訓練	10	10	7	7																																																																			
有害作業主管教育訓練	30	30	17	17																																																																			
年度	員工失能傷害		承攬商失能傷害	重大職災	職災比率																																																																		
2023	1 件	1 人	0	0	0.06%																																																																		
2024	2 件	2 人	0	0	0.11%																																																																		
年度	火災演練	毒災演練	火災件數	死傷人數	死傷比率																																																																		
2023	2 次	1 次	0 件	0 人	0%																																																																		
2024	2 次	0 次	0 件	0 人	0%																																																																		
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司已定期舉辦員工職涯能力發展教育訓練課程，詳請參閱本年報第 73 頁。			無差異																																																																	

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司重視客戶對各項服務滿意度及企業形象、品牌價值與服務品質的認知提供完善的產品解決方案及各種創新產品之提供。在產品開發設計、生產運送或維修服務等，均有專門負責的權責單位，期在最短時間內提供服務。	無差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司針對所有供應商及委外加工商進行社會環境責任評估，以確保供應商及委外加工商遵守相關法令。若供應商或委外加工商違反社會環境責任，將影響與本公司的業務合作關係。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		1. 公司依據全球永續性報告協會(GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2024 年永續報告書」，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群（包含其人權）重大主題與影響、揭露項目及其報導要求，並參考永續會計準則理事會（SASB）準則揭露行業指標資訊及 SASB 指標對應報告書內容索引。 2. 2024 年永續報告書包含對應 GRI 準則之內容索引，並預計於 2025 年 6 月依據 AA1000 標準查證，其查證結果與歷年報告書公開於公司永續發展網站 https://www.mpi.com.tw/esg/#ESG	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

本公司因應永續潮流，已分別於 111 年成立 ESG 永續發展專案、ISO 14064-1 溫室氣體盤查暨查證專案，推動公司永續作業。另強化員工道德風險，制定「員工及道德風險評估管理辦法」強化員工誠信廉潔內控作業。

本公司積極參與永續金融方案，112 年 3 月承作「綠色及永續新臺幣定期存款」達 1 億元，綠色投資為投入再生能源、綠建築融資，社會效益投資則包括均衡城鄉發展、弱勢照顧、興建教育設施及醫療院所等項目，展現對環境、社會、財務、公司治理永續營運的支持。

113 年 11 月承作「綠色定期存款」新台幣達 1 億元，綠色存款專案之金額，將運用於各項符合綠色債券原則項目或聯徵中心認可「綠色授信」註記之規範，綠色投資為投入再生能源案場融資、綠建築融資、電動車融資、廢轉能發電站融資、廢污水處理廠及其相關基礎建設融資等項目，持續投入永續發展。

113 年度捐贈慈善公益團體情形：

項次	受捐單位	捐款金額
1	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院	1,250,000
2	社團法人世界和平會	324,000
3	社團法人中華警政研究學會	200,000
4	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	180,000
5	新竹交響管樂團	100,000
6	新竹縣立交響管樂團	75,000
7	梅門功藝坊	50,000
8	財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心	29,548
9	社團法人中華安得烈慈善協會	27,973
10	社團法人中華民國救世慈善協會	26,216
11	財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會	24,919
12	新北市流浪動物保護協會	22,649
13	社團法人炬輪技藝發展協會	21,000
14	社團法人中華基督教救助協會	19,914
15	財團法人屏東縣私立磐石社會福利事業基金會	15,225
16	財團法人喜憨兒社會福利基金會	10,016
17	社團法人新竹縣竹北市泰和社區發展協會	10,000
合計		2,386,460

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形												
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 為因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化，並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響，定期召集各部門高階主管辨識重大氣候風險與機會。同時也進一步評估洪水、乾旱、颱風與高溫可能對各營運據點帶來的風險，期能掌握外在環境的氣候變化與市場動態，更全面地考量整體的營運策略規劃。 2. 本公司依據「氣候變遷災害風險調適平台」評估臺灣營運據點區域之潛在災害之危害度與脆弱度，透過 ESG 永續委員會旗下之安環能發展組，負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制。同時進行氣候變遷風險分析與因應，並由董事會監督治理。 3. 於董事會監督部分，每季溫室氣體盤查及查證時程規劃進度，以 ISO 14064-1 為基礎，進行氣候變遷因應作業，包含結合 ISO 22301 營運持續標準，針對氣候所造成之風險研擬因應作業。												
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	有關氣候變遷議題之風險與機會共有 32 項，經整理後可歸納以下： <table><tr><th>類型</th><th>風險／機會</th><th>因應策略</th></tr><tr><td>轉型風險</td><td> • 國內外溫室氣體與綠色規範法令遵循嚴峻 • 綠色轉型與技術開發不易・產品需求變化 • 影響公司聲譽與接单能力 </td><td> • 國內外碳稅與碳費徵收尚未對旺矽科技造成財務影響，仍持續密切關注國內外溫室氣體法規要求，以及銷售當地國之綠色規範 • 提前因應規劃減碳策略與碳權交易作業準備 • 與工研院等公協會專家合作，針對耗能廠務設備進行節能輔導 • 關注市場變化與透過研調機構進行產業分析 • 因應客戶稽核／調查需求提前布局 ESG 執行規劃 </td></tr><tr><td>實體風險</td><td> • 水災(自身營運、供應鏈) • 旱災(自身營運、供應鏈) • 高溫(自身營運、供應鏈) • 提高天災緊急應對能力 </td><td> • 導入 ISO 22301 營運持續管理系統，針對衝擊大之風險建立應變計畫以提高風險發生之應變能力 </td></tr><tr><td>氣候相關機會</td><td> • 提升廠房能源使用效率與節能措施 • 再生能源與儲能設備建置 • 研發高效能、環境友善產品 • 提升企業商譽 • 提高營運持續韌性 </td><td> • 新廠區節能措施建置規劃、現有廠區廠務節能作業持續推動 • 與大專院校合作研究，持續針對產品技術方法革新與替代料件研究 • 驗證 ISO 22301 營運持續管理系統，提高客戶信任與增強營運韌性 </td></tr></table>	類型	風險／機會	因應策略	轉型風險	• 國內外溫室氣體與綠色規範法令遵循嚴峻 • 綠色轉型與技術開發不易・產品需求變化 • 影響公司聲譽與接单能力	• 國內外碳稅與碳費徵收尚未對旺矽科技造成財務影響，仍持續密切關注國內外溫室氣體法規要求，以及銷售當地國之綠色規範 • 提前因應規劃減碳策略與碳權交易作業準備 • 與工研院等公協會專家合作，針對耗能廠務設備進行節能輔導 • 關注市場變化與透過研調機構進行產業分析 • 因應客戶稽核／調查需求提前布局 ESG 執行規劃	實體風險	• 水災(自身營運、供應鏈) • 旱災(自身營運、供應鏈) • 高溫(自身營運、供應鏈) • 提高天災緊急應對能力	• 導入 ISO 22301 營運持續管理系統，針對衝擊大之風險建立應變計畫以提高風險發生之應變能力	氣候相關機會	• 提升廠房能源使用效率與節能措施 • 再生能源與儲能設備建置 • 研發高效能、環境友善產品 • 提升企業商譽 • 提高營運持續韌性	• 新廠區節能措施建置規劃、現有廠區廠務節能作業持續推動 • 與大專院校合作研究，持續針對產品技術方法革新與替代料件研究 • 驗證 ISO 22301 營運持續管理系統，提高客戶信任與增強營運韌性
類型	風險／機會	因應策略											
轉型風險	• 國內外溫室氣體與綠色規範法令遵循嚴峻 • 綠色轉型與技術開發不易・產品需求變化 • 影響公司聲譽與接单能力	• 國內外碳稅與碳費徵收尚未對旺矽科技造成財務影響，仍持續密切關注國內外溫室氣體法規要求，以及銷售當地國之綠色規範 • 提前因應規劃減碳策略與碳權交易作業準備 • 與工研院等公協會專家合作，針對耗能廠務設備進行節能輔導 • 關注市場變化與透過研調機構進行產業分析 • 因應客戶稽核／調查需求提前布局 ESG 執行規劃											
實體風險	• 水災(自身營運、供應鏈) • 旱災(自身營運、供應鏈) • 高溫(自身營運、供應鏈) • 提高天災緊急應對能力	• 導入 ISO 22301 營運持續管理系統，針對衝擊大之風險建立應變計畫以提高風險發生之應變能力											
氣候相關機會	• 提升廠房能源使用效率與節能措施 • 再生能源與儲能設備建置 • 研發高效能、環境友善產品 • 提升企業商譽 • 提高營運持續韌性	• 新廠區節能措施建置規劃、現有廠區廠務節能作業持續推動 • 與大專院校合作研究，持續針對產品技術方法革新與替代料件研究 • 驗證 ISO 22301 營運持續管理系統，提高客戶信任與增強營運韌性											
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1. 本公司透過 ESG 委員會與安環能發展小組依據「氣候變遷災害風險調適平台」評估臺灣營運據點區域之潛在災害之危害度與脆弱度，並依據 ISO 22301 營運												

	持續管理系統(BCM)辨識出洪災、旱災，以及降水模式變化和氣候模式的極端變化等對生產或運輸階段有潛在風險。 2. 強降雨造成的洪災會造成營運據點部分停工(包含員工無法作業)，以及設備損壞(如淹水)導致短暫無法生產並影響交貨期；而乾旱雖不致嚴重影響產線正常運作，惟仍因應降低用水、水車運水維持供貨做準備，將造成營運成本提升。 3. 在遭遇高溫，可能造成廠務設備溫度過高造成當機或燒毀情形，因應如每個重要產線多有備援設備、並透過智慧管理系統嚴格管控溫度並進行調節。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	1. 董事會為風險控管的最高決策單位，直接監督集團內各公司風險治理架構。為健全風險評估及強化管理機能，自 2023 年起，由總經理領導之 ESG 永續委員會皆須定期向董事會報告，負責辨識和管理企業永續營運之風險，包含氣候變遷可能帶來之實體與轉型風險，並主導相關因應措施之規劃。 2. 為強化氣候變遷因應與營運不中斷韌性，使客戶與投資人更能安心。本公司於 2024 年起導入 ISO 22301 營運持續管理系統(BCM)，制定營運持續管理手冊與程序，從上而下強化營運持續風險管理，包含產線應變、供應鏈韌性與財務穩健。並業於 2024 年 12 月 20 日取得 BCM 第三方驗證(LRQA)證書，證明本公司在營運持續管理符合國際標準並可運作。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司依據 ISO 31000 風險管理架構進行氣候變遷風險之韌性分析，並取得第三方驗證。透過 BCP 營運持續計劃針對氣候變遷風險進行財務影響評估與準備，對於對財務可能嚴重影響的關鍵營運活動(PAs)，優先提供財務支援或準備，如產物保險投保或現金準備。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	為了達成淨零排放，本公司已於 2024 年擬定減碳專案計劃，並於 2025 年 1 月正式執行，將分別針對營運活動的直接排放(範疇一)、能源使用的間接排放(範疇二)進行減量。執行內容包含： 1. 持續積極自願減碳：本公司非列管之排碳大戶，但朝向自願減量作業，包含導入 EMS、優化與更新廠務設施，提升能源生產力及使用效率，將製造及產品使用階段之碳排降到最低。 2. 採用再生能源：除既有廠區已架設 963KW 太陽能發電，同時架設電動車充電樁鼓勵同仁使用電動車。並針對新廠區

	進行太陽能再生能源建置評估。 3. 投資淨零技術：未來將參與碳抵減相關專案，以抵減不可避免的碳排放。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	將依 IFRS 實施時程評估規劃內部碳定價作業。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	母公司已完成 112 年溫室氣體盤查、113 年度盤查與查證作業預計第二季完成，並已依「上市櫃永續發展路徑圖」規劃各子公司盤查與查證時程。本公司尚未使用 RECs 或碳抵換機制。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請詳以下說明。

1、最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

溫室氣體排放涵蓋範圍：母公司全廠區

盤查年	範疇一	範疇二	範疇三	總計	密集度 (CO ₂ e/當年母公司百萬元營收)
2023 年	1,441.2795	18,601.9278	6,911.8828	26,955.0901	4.024
2024 年	1,432.9036	19,171.9760	7,405.4156	28,010.2952	2.754

(2)溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

1. 本公司已於 2023 年完成溫室氣體查證(查證單位：BSI)，於 2024 年完成第二次查證(查證單位：DQS)，預計於 2025 年 6 月完成第三次查證(查證單位：DQS)。
2. 上述查證依據 ISO 14064-1:2018、ISO 14064-3:2019 以及 Greenhouse Gas Protocol，查證範圍包含本公司臺灣所有據點廠區，均無保留意見。

2、溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

1. 本公司於 2024 年設定減碳目標(範疇 1 與 2)，目標如下(以 2022 年為減碳基準年)：
 - (1) 第一階段 2027 年減碳 5%；
 - (2) 第二階段 2030 年減碳 10~20%；
 - (3) 第三階段 2040 年實現碳中和。
2. 針對第一階段，已於 2025 年 1 月啟動減碳專案，預計投資 2,500 萬元進行如下：

- (1) 設備汰換與升級-遵循 ISO5001 能源管理系統標準，提出節能方案。
- (2) 全面能源健檢-與公協會合作展開各廠區能源健檢，提出節能方案與 EMS 建制方案。
- (3) EMS 可視化管理-建置智慧化 EMS 能源系統，分析優化能源使用及配置，並透過能源監控提出有效益的節能方案。
- (4) 自願減量專案-將符合申請資格的節能方案向環境部申請自願減量專案，取得碳權額度，作為未來抵換碳費使用及碳中和目標宣告。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司為恪遵法令及謹守道德規範之企業，除遵循公司法、證券交易法等規章法令外，並秉持「誠信原則」經營理念，經董事會通過訂定本公司誠信經營守則。並由人力資源部為推動單位，制定「誠信經營與從業道德規範」，建立良好之公司治理及風險控管機制，謀求本公司之永續發展，董事會與管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策執行。	無差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		1. 本公司已於「誠信經營與從業道德規範」訂定嚴謹行為規範及道德準則，並明訂相關獎懲規定，舉凡本公司董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，嚴禁直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以防範營私舞弊、挪用公款、收受賄賂、洩密或謊報等不誠信行為。 2. 本公司依據「誠信經營與從業道德規範」定期分析檢討具較高不誠信行為風險之營業活動，包含明訂相關從業人員應每年進行利益衝突申報，包含業務、採購、財會單位人員以及其他指定人員；每年進行「勞工及道德風險評估」，定期評估針對道德風險較高之活動進行風險評估，以防範弊端或不道德情事發生。	無差異

(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		本公司於「誠信經營與從業道德規範」明示誠信經營之道德規範政策，及相關作業程序、行為指南、檢舉、違規懲戒、申訴等規定，並針對本公司董事及經理人已訂立「道德行為準則」，上述規章制度均定期檢討，以因應實務所需。	無差異
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司與往來交易對象已有「保密契約」中明訂誠信行為條款，落實公司誠信經營政策。	無差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		- 由本公司人力資源部兼職推動企業誠信經營之運作，包括宣導誠信經營政策，及舉辦誠信經營相關議題之教育訓練，並依本公司檢舉辦法，處理查核相關檢舉案件等。 - 誠信經營推動單位每年至少一次向董事會報告，最近一次報告日期為 2024 年 11 月 12 日，主要報告誠信經營之政策、作法、執行情形，最近一次報告項目如下，並獲董事會認可並同意持續作業： - 教育訓練辦理：參訓人數 1,845 人次，合計 1,845 人時。 - 新進人員服務合約書簽署：應簽署人數 264 人，已簽署 264 份，達成比率 100%。 - 利益衝突申報：(包含新進人員及主管、業務、採購、財會等人員)，應申報人數 388 人，已申報 388 人，占全體員工比率 21.3%。 - 申訴、舉報管道：(包含專用電話及專用信箱)，經查核收到檢舉案件 0 件。 - 勞工及道德風險評估：評估對象 1,700 人，評估內容 61 項，皆落在風險最低等級。	無差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司已於「董事會議事規範」明訂董事對於對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事	無差異

			會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 2. 本公司已於「誠信經營與從業道德規範」、「員工獎懲辦法」、「服務合約書」等明訂員工應嚴謹遵守利益迴避之行為準則，主動報備有利益衝突等道德疑慮事項，並訂有競業禁止相關條款，以防止利益衝突。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司建立有效之會計制度、內部控制制度，稽核人員並定期查核制度遵循之情形。	無差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司 2024 年度舉辦誠信經營、從業道德、反貪腐等議題教育訓練，參訓人數 1,845 人次，合計 1,845 人次。	無差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司訂有「誠信經營與從業道德規範」規定，提供有獨立檢舉信箱 whistleblower@mpi.com.tw 與免付費檢舉專線 0800-888-089，同時內網有員工意見信箱等提供舉報任何違法或不當行為之陳述管道，並由人力資源部為專責單位。	無差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		檢舉案件受理後，由人力資源部專責進行案件審核、立案及後續調查之程序，並記錄於「違反誠信、道德行為自主通報(或檢舉)調查處理記錄表」。如屬於特殊情形(如被檢舉人具董事身分、或達到一定金額等)，則須向董事會報告。	無差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司依據「誠信經營與從業道德規範」對檢舉人的個人資料與資訊安全政策予以嚴格保密(高機密性)，且可匿名檢舉等措施保護。	無差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司網站及公開資訊觀測站已揭露「誠信經營守則」，同時將誠信經營成效與推動成果揭露於 ESG 永續報告書與官方網站。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

113 年本公司董事進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	進修日期	課程名稱	進修時數
董事長	旺矽投資股份有限公司代表人：葛長林	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
董事	旺矽投資股份有限公司代表人：陳四桂	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
董事	旺矽投資股份有限公司代表人：郭遠明	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
董事	李篤誠	財團法人台北金融研究發展基金會	113.08.06	公司治理-從證券交易法看企業及董監事責任義務	3
		社團法人中華公司治理協會	113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
董事	劉方勝	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
董事	蔡長壽	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
獨立董事	高進振	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
獨立董事	許梅芳	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
獨立董事	廖大穎	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
			113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3

(八)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

旺矽科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 12 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 12 日董事會通過，出席董事九人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

旺矽科技股份有限公司

董事長：葛長林

簽章

總經理：郭遠明

簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

董事會之重要決議：

董事會重要 決議日期	重要決議	證交法 §14-3 或 §14-5 所 列事項	獨立董事 意見及公 司對意見 之處理
第 10 屆 第 5 次 113.1.31	本公司 113 年度營運計畫		無
	113 年度員工暨董監酬勞提撥比率		無
	薪資報酬委員會審議本公司經理人之薪資報酬		無
第 10 屆 第 6 次 113.3.7	112 年度員工暨董事酬勞分派		無
	112 年度營業報告書及財務報表	✓	無
	112 年度盈餘分配現金股利		無
	評估 113 年度簽證會計師獨立性及適任性		無
	修訂本公司「股東會議事規則」	✓	無
	修訂本公司「董事會議事規範」	✓	無
	修訂「審計委員會組織規程」	✓	無
	修訂「銷貨及收款循環」	✓	無
	112 年度內部控制制度聲明書	✓	無
	113 年股東常會日期、地點及議程		無
	本公司自地委建廠房工程	✓	無
	本公司擬繼續處分韓國子公司股權		無
第 10 屆 第 7 次 113.5.8	本公司 113 年第一季財務報告	✓	無
	本公司自地委建廠房工程	✓	無
第 10 屆 第 8 次 113.8.13	112 年永續報告書討論案		無
	薪資報酬委員會提送本公司經理人之員工酬勞案		無
	本公司 113 年第二季財務報告案	✓	無
第 10 屆 第 9 次 113.9.23	本公司核決權限表修訂案	✓	無
	本公司取得機器設備及廠務工程案	✓	無
	本公司擬收購股權案		無
第 10 屆 第 10 次 113.11.12	本公司 113 年第三季財務報告案	✓	無
	增訂本公司「永續資訊之管理作業辦法」案	✓	無
	增訂本公司「永續報告書編製及查證作業辦法」案	✓	無
	修訂本公司「MIS 循環架構」案	✓	無
	本公司 114 年度內部稽核計劃之討論案	✓	無
	本公司擬募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債案	✓	無
第 10 屆 第 11 次	本公司 114 年度營運計畫之討論案		
	114 年度員工暨董事酬勞提撥比率之討論案		無

114.1.14	薪資報酬委員會審議本公司經理人之薪資報酬之討論案		無
第 10 屆 第 12 次 114.3.12	113 年度員工暨董事酬勞分派案		無
	113 年度營業報告書及財務報表案	✓	無
	113 年度盈餘分配現金股利之討論案		無
	修訂本公司「公司章程」之討論案	✓	無
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	✓	無
	113 年度內部控制制度聲明書之討論案	✓	無
	114 年股東常會日期、地點及議程之討論案		無
	本公司財務報表查核簽證會計師之變更案	✓	無
	評估 114 年度簽證會計師獨立性及適任性案		無
	本公司擬繼續處分韓國子公司股權案		無
	本公司自地委建二期工程追加案	✓	無
第 10 屆 第 13 次 114.3.17	本公司擬購置湖口工業區之土地及廠房案	✓	無
第 10 屆 第 14 次 114.4.22	買回本公司庫藏股案	✓	無
第 10 屆 第 15 次 114.5.9	本公司 114 年第一季財務報告	✓	無
	增列 114 年股東常會議案之報告事項議案		無

113 年度股東常會之重要決議執行情形：

股東常會重要 決議日期	重要決議	執行情形
股東常會 113.06.13	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	全體出席股東無異議照案通過
	承認 112 年度盈餘分派案	全體出席股東無異議照案通過，現金股利配發 7.5 元。 除息基準日：113.07.19 現金股息發放日：113.08.02

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十一)其他應揭露事項：

113 年度本公司公司治理主管、會計主管及稽核主管進修情形如下：

職 稱	姓 名	進修機構	進修日期	課程名稱	進修時數
公司治 理主管	湯 復 評	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113.03.06	2024 年經濟展望及產業趨勢	3
		社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3

		社團法人中華公司治理協會	113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
會計主管	饒雲珍	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113.11.21 至 113.11.22	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	劉怡萍	內部稽核協會	113.06.04	永續資訊揭露政策解析與內控內稽重點研討	6
		內部稽核協會	113.11.28	永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	6

四、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
日正聯合會計師事務所	陳枝凌	113.01.01 至 113.12.31	3,149	273	3,422	稅務簽證公費 273 仟元
	陳依玲	113.01.01 至 113.12.31				

(二)公司有下列情事之一者，應揭露會計師公費：

- (1)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無。
- (2)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
- (3)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊： 無。

(一)關於前任會計師：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 114 年 4 月 30 日止	
		持有股數 增 (減) 數	質押股數 增 (減) 數	持有股數 增 (減) 數	質押股數 增 (減) 數
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人:葛長林	0	0	0	0
董事	旺矽投資(股)公司 代表人:陳四桂	0	0	0	0
董事	旺矽投資(股)公司 代表人:郭遠明	0	0	0	0
董事	劉方勝	0	0	0	0
董事	李篤誠	(60,000)	0	0	0
董事	蔡長壽	0	0	0	0
獨立董事	許梅芳	(111,000)	0	0	0
獨立董事	高進振	(2,000)	0	0	0
獨立董事	廖大穎	0	0	0	0
總經理	郭遠明	(7,000)	0	0	0
副總經理	范維如	0	0	0	0
副總經理	劉永欽	(6,000)	0	0	0
財務主管 公司治理主管	湯復評	0	0	0	0
會計主管	饒雲珍	0	0	0	0
分公司經理	汪建明	(1,000)	0	0	0

(二)股權移轉資訊或股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114 年 4 月 30 日

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
旺矽投資股份有限公司 負責人:葛長林	8,334,626	8.84%	0	0%	0	0%	旺矽投資(股)公司	本公司董事	無
	1,425,994	1.51%	427,781	0.45%	0	0%	旺矽投資(股)公司	本公司董事長	無
新制勞工退休基金	5,912,500	6.27%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
富邦人壽保險股份有限公司負責人:林福星	2,468,000	2.62%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
	0	0%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
舊制勞工退休基金	2,053,300	2.18%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
永豐商銀受旺矽科技員工持股信託財產專戶	1,888,837	2.00%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1,546,000	1.64%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
公務人員退休撫卹基金管理委員會	1,499,000	1.59%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
葛長林	1,425,994	1.51%	427,781	0.45%	0	0%	旺矽投資(股)公司	本公司董事長	無
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1,149,000	1.22%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
國泰小龍基金專戶	1,047,000	1.11%	0	0%	0	0%	無	無關係	無

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。

113 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業 (註 1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
長洛國際(股)公司	5,000,000	100%	0	0	5,000,000	100%
MPI TRADING CORP.	1,000	100%	0	0	1,000	100%
MMI HOLDING CO., LTD.	18,267,987	100%	0	0	18,267,987	100%
均揚電子(股)公司	1,550,000	100%	0	0	1,550,000	100%
MEGTAS CO., LTD.	400,000	80%	0	0	400,000	80%
MPA TRADING COR.	11,450,000	100%	0	0	11,450,000	100%
MPI AMERICA INC. (註 2)	0	0%	6,300,000	子公司 100% 持有	6,300,000	100%
琉明光電(常州)有限公司 (註 3)	0	0%	16,000,000 美元	子公司 100% 持有	16,000,000 美元	100%
旺矽科技(蘇州)有限公司 (註 4)	0	0%	2,000,000 美元	子公司 100% 持有	2,000,000 美元	100%
Celadon Systems Inc. (註 5)	0	0%	1,000	子公司 100% 持有	1,000	100%

註 1：係公司之長期投資。

註 2：係本公司之子公司 - MPA TRADING CORP. 之轉投資公司。

註 3：係本公司之子公司 - MMI HOLDING CO., LTD. 之轉投資公司。

註 4：係本公司之子公司 - MMI HOLDING CO., LTD. 之轉投資公司。

註 5：係本公司之子公司 - MPI AMERICA INC. 之轉投資公司。

參、募集情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

114 年 4 月 30 日 單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
84/07	10	500	5,000	500	5,000	設立資本	無	
87/10	10	22,500	225,000	6,000	60,000	現金增資 55,000 仟元	無	
89/07	15 10	22,500	225,000	10,000	100,000	現金增資 28,000 仟元 盈餘轉增資 12,000 仟元	無	
90/05	18 10 10	22,500	225,000	20,000	200,000	現金增資 50,700 仟元 盈餘轉增資 42,000 仟元 員工紅利轉增資 7,300 仟元	無	
91/06	10	50,000	500,000	30,000	300,000	盈餘轉增資 43,800 仟元 員工紅利轉增資 6,200 仟元	受讓長洛公司 股份 50,000 仟元	註 1
92/09	10	50,000	500,000	33,434	334,340	盈餘轉增資 30,000 仟元 員工紅利轉增資 4,340 仟元	無	註 2
93/08	10	50,000	500,000	33,803	338,031	可轉債轉換普通股 3,691 仟元	無	
93/09	10	50,000	500,000	37,672	376,719	盈餘轉增資 33,434 仟元 員工紅利轉增資 5,254 仟元	無	註 3
93/11	10	50,000	500,000	38,217	382,174	可轉債轉換普通股 5,454 仟元	無	
94/02	10	50,000	500,000	38,877	388,775	可轉債轉換普通股 6,601 仟元	無	
94/05	10	50,000	500,000	39,556	395,556	可轉債轉換普通股 6,781 仟元	無	
94/07	10	50,000	500,000	39,576	395,765	可轉債轉換普通股 208 仟元	無	
94/09	10	51,300	513,000	48,957	489,568	盈餘轉增資 81,960 仟元 員工紅利轉增資 11,814 仟元 可轉債轉換普通股 30 仟元	無	註 4
94/10	10	51,300	513,000	49,253	492,533	可轉債轉換普通股 2,964 仟元	無	
95/02	10	51,300	513,000	50,479	504,785	可轉債轉換普通股 12,253 仟元	無	
95/05	10	51,300	513,000	50,724	507,236	可轉債轉換普通股 2,451 仟元	無	
95/08	10	51,300	513,000	50,815	508,145	可轉債轉換普通股 909 仟元	無	
95/09	10	58,000	580,000	56,496	564,959	盈餘轉增資 50,814 仟元 員工紅利轉增資 6,000 仟元	無	註 5
96/08	10	100,000	1,000,000	56,501	565,005	可轉債轉換普通股 45 仟元	無	
96/09	10	100,000	1,000,000	63,676	636,758	盈餘轉增資 57,500 仟元 員工紅利轉增資 8,118 仟元 可轉債轉換普通股 6,135 仟元	無	註 6
96/10	10	100,000	1,000,000	63,679	636,789	可轉債轉換普通股 30 仟元	無	
97/01	10	100,000	1,000,000	63,736	637,363	可轉債轉換普通股 574 仟元	無	
97/09	10	100,000	1,000,000	71,105	711,053	盈餘轉增資 64,570 仟元 員工紅利轉增資 9,120 仟元	無	註 7
98/08	10	100,000	1,000,000	73,311	733,111	盈餘轉增資 21,190 仟元 員工紅利轉增資 868 仟元	無	註 8
98/12	10	100,000	1,000,000	74,084	740,841	員工認股權轉換普通股 100 仟元 可轉債轉換普通股 7,630 仟元	無	
99/04	10	100,000	1,000,000	77,449	774,486	員工認股權轉換普通股 11,190 仟元 可轉債轉換普通股 22,455 仟元	無	
99/07	10	100,000	1,000,000	77,629	776,291	員工認股權轉換普通股 11,082 仟元 可轉債轉換普通股 3,200 仟元	無	

99/10	10	100,000	1,000,000	77,697	776,970	員工認股權轉換普通股 5,376 仟元 可轉債轉換普通股 200 仟元	無	
100/01	10	100,000	1,000,000	77,985	779,854	員工認股權轉換普通股 13,149 仟元 可轉債轉換普通股 8,900 仟元	無	
100/04	10	100,000	1,000,000	78,464	784,644	員工認股權轉換普通股 39,613 仟元	無	
100/08	10	100,000	1,000,000	78,549	785,494	員工認股權轉換普通股 7,030 仟元	無	
100/10	10	100,000	1,000,000	78,590	785,904	員工認股權轉換普通股 3,299 仟元	無	
101/01	10	100,000	1,000,000	78,602	786,024	員工認股權轉換普通股 931 仟元	無	
101/04	10	100,000	1,000,000	78,605	786,054	員工認股權轉換普通股 233 仟元	無	
101/07	10	100,000	1,000,000	78,610	786,104	員工認股權轉換普通股 388 仟元	無	
102/07	10	100,000	1,000,000	78,612	786,123	員工認股權轉換普通股 143 仟元 股東申請拋棄持股之註銷減資 8 股	無	
104/01	10	100,000	1,000,000	79,536	795,364	可轉債轉換普通股 92,400 仟元	無	
104/05	10	100,000	1,000,000	79,605	796,054	可轉債轉換普通股 6,900 仟元	無	
106/08	10	100,000	1,000,000	79,901	799,014	可轉債轉換普通股 26,700 仟元	無	
108/08	10	120,000	1,200,000	79,915	799,154	可轉債轉換普通股 1,000 仟元	無	
109/01	10	120,000	1,200,000	79,959	799,587	可轉債轉換普通股 3,000 仟元	無	
109/08	10	120,000	1,200,000	80,294	802,940	可轉債轉換普通股 23,200 仟元	無	
109/10	10	120,000	1,200,000	91,068	910,684	可轉債轉換普通股 726,200 仟元	無	
110/01	10	120,000	1,200,000	92,080	920,802	可轉債轉換普通股 68,200 仟元	無	
110/04	10	120,000	1,200,000	92,381	923,813	可轉債轉換普通股 20,300 仟元	無	
110/08	10	120,000	1,200,000	93,000	930,001	可轉債轉換普通股 41,700 仟元	無	
110/11	10	120,000	1,200,000	94,074	940,738	可轉債轉換普通股 69,900 仟元	無	
111/04	10	120,000	1,200,000	94,078	940,784	可轉債轉換普通股 300 仟元	無	
111/11	10	120,000	1,200,000	94,231	942,311	可轉債轉換普通股 9,500 仟元	無	

註 1：經財政部證券暨期貨管理委員會 91.06.03 (91) 第 09100127510 號函核准。

註 2：經財政部證券暨期貨管理委員會 92.07.02 台財證一字第 0920129426 號函核准。

註 3：經財政部證券暨期貨管理委員會 93.06.15 台財證一字第 0930126472 號函核准。

註 4：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 94.6.16 金管證一字第 0940124109 號函核准。

註 5：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 95.7.17 金管證一字第 0950130971 號函核准。

註 6：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 96.7.12 金管證一字第 0960036186 號函核准。

註 7：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 97.6.25 金管證一字第 0970031732 號函核准。

註 8：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 98.7.8 金管證發字第 0980034020 號函核准。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	94,231,106 股	25,768,894 股	120,000,000 股	上櫃公司股票

(二)主要股東名單

114 年 4 月 30 日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
旺矽投資股份有限公司	8,334,626	8.84%
新制勞工退休基金	5,912,500	6.27%
富邦人壽保險股份有限公司	2,468,000	2.62%
舊制勞工退休基金	2,053,300	2.18%
永豐商銀受旺矽科技員工持股信託財產專戶	1,888,837	2.00%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1,546,000	1.64%
公務人員退休撫卹基金管理委員會	1,499,000	1.59%

葛長林	1,425,994	1.51%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1,149,000	1.22%
國泰小龍基金專戶	1,047,000	1.11%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

第十九條：本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之零點一至百分之十五作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。

第二十條：本公司目前產業發展屬成長階段，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬定盈餘分派案，提報股東會。

盈餘之分派將視資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採現金股利或股票股利之方式發放，其中現金股利之發放，以不低於股利總額之10%為原則。

2. 本年度股東會擬議股利分配之情形

本公司113年度盈餘分派案，業經114年3月12日之董事會通過擬議配發股東現金股利新台幣1,507,697,696元(每股新台幣16元)。

3. 股利政策預期是否有重大變動：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次股東常會未擬議無償配股，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

第十九條：本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之零點一至百分之十五作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。

第二十條：本公司目前產業發展屬成長階段，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬定盈餘分派案，提報股東會。

盈餘之分派將視資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採現金股利或股票股利之方式發放，其中現金股利之發放，以不低於股利總額之10%為原則。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分配金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之零點一至百分之十五作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。如實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，認列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司 113 年度盈餘分配議案，已於民國 114 年 3 月 12 日董事會決議通過，有關董事會通過之擬議盈餘分配情形如下：

- (1) 以現金分派之員工酬勞新台幣 249,429,000 元及董事酬勞新台幣 62,357,391 元，與認列費用年度估列金額並無差異。
- (2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分配情形(包括分配股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

單位：新台幣元

項 目	金 額
員工現金酬勞	138,653,000
董事酬勞	34,663,212

112 年度員工及董事酬勞實際分派金額與認列金額無差異。

- (六)買回本公司股份情形(尚在執行中)：

114 年 4 月 30 日

買回期次	第四次(期)
買回目的	維護股東權益
買回股份之種類	普通股
買回股份之種金額上限	6,771,462,147 元
預定買回之期間	114.04.23~114.06.22
預定買回之數量	2,000,000 股
買回之區間價格	391~900
已買回股份種類及數量	普通股 0 股
已買回股份金額	0 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	0.00%

二、公司債辦理情形：

(一)公司債辦理情形：

114 年 4 月 30 日

公司債種類 (註 2)	國內第五次無擔保轉換公司債
發行 (辦理) 日期	中華民國 114 年 01 月 08 日
面 額	新台幣 100,000 元
發行及交易地點(註 3)	不適用
發 行 價 格	新台幣 100,000 元
總 額	發行總面額：新台幣 3,500,000,000 元 每張面額：新台幣 100,000 元(依票面金額之 100.5%發行)
利 率	票面年利率為 0%
期 限	5 年期，到期日：119 年 01 月 08 日
保 證 機 構	不適用
受 託 人	永豐商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構	凱基證券股份有限公司
簽 證 律 師	翰辰法律事務所 彭義誠律師
簽 證 會 計 師	日正聯合會計師事務所 陳枝凌、陳依玲會計師
償 還 方 法	依辦法轉換為公司普通股，依辦法行使賣回權或由本公司依辦法提前贖回者，或本公司買回註銷者外，本公司於債券到期時依債券面額以現金一次償還。
未 償 還 本 金	新台幣 3,500,000,000 元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	(一)本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114 年 4 月 9 日)起至發行期間屆滿前四十日(118 年 11 月 29 日)止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達 30%(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後 5 個營業日(含第 5 個營業日)內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。 (二)本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114 年 4 月 9 日)起至發行期間屆滿前四十日(118 年 11 月 29 日)止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之 10%時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方

		式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回該債券持有人之本轉換公司債，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後5個營業日(含第5個營業日)內，按債券面額以現金收回該債券持有人之本轉換公司債。
限制條款(註4)		無
信用評等機構名稱、評等日 期、公司債評等結果		無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年4月9日)起，至到期日(119年1月8日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		轉換公司債在債權人未要求執行轉換權利前，對公司並無股權稀釋作用，債權人在可轉換期間內可選擇對其較有利之時間點進行轉換，因此對股權稀釋具有遞延之效果。再就對現有股東權益之影響觀之，雖轉換公司債於轉換前會增加公司負債，但隨著轉換公司債轉換為普通股時，除了將會降低負債外，亦會增加股東權益，進而提高每股淨值，因此就長期而言對現有股東權益較得以保障。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(二)轉換公司債資料：

公 司 債 種 類 (註 1)		國內第五次無擔保轉換公司債		
年 度		112 年度	113 年度	當 年 度 截 至 114 年 04 月 30 日 (註 4)
項 目	轉 債 (註 2) 換 市 公 價 (註 2) 司			121.60
	最 高			96.50
	最 低			115.61
	平 均			930.00
轉 換 價 格				114.01.08 930.00
發 行 (辦 理) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格				發 行 新 股
履 行 轉 換 義 務 方 式 (註 3)				

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註 3：交付已發行股份或發行新股。

註 4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(三)總括申報發行公司債情形：

114 年 4 月 30 日

預定募集與發行總額	新台幣 3,517,500,000 元
已募集發行總額 (含各次發行(辦理)日期及發行金額)	發行日期：114.01.08 發行金額：新台幣 3,517,500,000 元
總括申報餘額	新台幣 3,500,000,000 元
未辦理部分預定發行期間	不適用

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容：

1. 目的事業主管機關核准日期及文號：金融監督管理委員會 113 年 12 月 23 日金管證發字第 1130366455 號函。
2. 本次計畫所需資金總額：3,517,500 仟元。
3. 資金來源：
 - (1)發行國內第五次無擔保轉換公司債 35,000 張，每張面額新台幣 10 萬元整，發行總面額為 3,500,000 仟元，依票面金額之 100%~101%發行，發行期間五年，票面利率 0%。
 - (2)如實際發行時因未足額發行導致募集資金不足時，將以自有資金及/或銀行借款支應；惟若募集資金增加時，則作為充實營運資金之用。

4. 計畫項目及預計進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			114 年度	
			第一季	第二季
償還銀行借款	114 年第一季	900,000	900,000	-
充實營運資金	114 年第二季	2,617,500	1,617,500	1,000,000
合計		3,517,500	2,517,500	1,000,000

5. 預計可能產生效益

本次計畫項目中，900,000 仟元用以償還銀行借款，依據預計償還之金額及借款利率估算，預計 114 年可以節省利息支出 16,541 仟元，往後每年可以節省利息支出 18,045 仟元；本次計畫項目中，2,617,500 仟元用以充實營運資金，以本公司目前短期借款平均利率為 1.86%設算，預計 114 年可節省利息支出 44,628 仟元，往後每年可以節省利息支出 48,686 仟元。

(二)執行情形：

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況			進度超前或落後情形、 原因及改進計畫
償還銀行借款	支用金額 (新台幣仟元)	預定	900,000	依原定進度全數執行完畢。
		實際	900,000	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	100.00	
充實營運資金	支用金額 (新台幣仟元)	預定	2,617,500	依原定進度部份執行完畢。
		實際	1,617,500	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	61.79	
合計	支用金額	預定	3,517,500	依原定進度部份執行完畢。

	(新台幣仟元)	實際	2,517,500	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	71.57	

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容如下：
 - (1) 電腦及週邊設備維護買賣研發。
 - (2) 半導體元件、電子零件、晶體積體電路之進出口買賣。
 - (3) 精密自動化控制機器之進出口買賣。
 - (4) 機械及其零件之進出口買賣。
 - (5) 一般進出口貿易業務。(許可業務除外)
 - (6) 半導體測試零組件加工維修、製造、進出口買賣。
 - (7) 代理國內外廠商前各項產品之報價、投標業務。
 - (8) 機械設備製造業。
 - (9) 機械批發業。
 - (10) 機械器具零售業。
2. 營業比重

本公司 113 年度合併營收淨額為新台幣 10,171,861 仟元，營收來源主要是晶圓探針卡及半導體設備之銷售，其各商品（服務）之營業比重如下：

單位：新台幣仟元

商品（服務）項目	113 年度	
	銷售淨額	營業比重%
晶圓探針卡	6,596,924	64.85%
半導體設備	3,226,927	31.72%
其 他	348,010	3.43%
合 計	10,171,861	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目
 - (1) 晶圓探針卡
 - (2) 晶圓探針卡維修
 - (3) 晶圓測試與分選設備
 - (4) 半導體晶圓與元件之測試、分選與光學檢查設備
4. 計畫開發之新商品(服務)
 - (1) 晶圓探針卡
 - (a) 因應半導體晶圓製程技術規格的提升，持續開發極小間距、高針數、大面積、高低溫、少清針及多晶片平行測試之晶圓探針卡。
 - (b) 因應高速、高頻晶片發展的趨勢，持續開發高速、高頻測試之晶圓探針卡。
 - (c) 因應先進封裝技術發展及應用產品的不同，持續開發高整合度的 FOWLP、KGD、覆晶、CIS、TSV、WLP、SiP、SoC、2.5D、InFO、CoWoS、矽光子及 3D 立體堆疊晶片測試用之先進式晶圓探針卡。
 - (2) 半導體設備
 - (a) Micro LED 微顯示元件之晶圓及測試系統，包含高防震設備開發，以及微米 (um) 等級發光元件之量測能力。
 - (b) 光通訊元件 VCSEL、EEL、DFB 等之光電特性量測設備。
 - (c) 矽光子晶粒等級 (Chip Level) 量測設備，可運用於 PIC、EIC+PIC 晶圓切割後的 KGD 製成測試 (Known Good Die process)，包含相關的光電轉換特性量測，以及高頻元件的頻寬與雜訊測試。
 - (d) 自動化系統軟體共用平台，簡化程式編碼需求 (Low Code)、節點式流程導向設計 (Node Flow)，加快自動化應用開發時程。

(二) 產業概況

(A) 產業之現況與發展

(1) 全球行業現況

(a) 晶圓探針卡(半導體產業)

半導體產業鏈上游為 IC 設計業，中游為 IC 晶圓製造，下游為 IC 封裝測試。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠製作成晶圓半成品，完成前段晶圓測試後，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，再將測試後之成品裝配成為產品。

IC 測試則可分為兩階段，一是進入封裝之前的晶圓測試，主要測試晶片上晶粒的電性。另一則為 IC 成品測試，主要在測試 IC 功能、電性與散熱是否正常，以確保品質。探針卡則是使用於晶圓測試階段，對晶片上的每個晶粒進行針測。

探針卡(Probe Card)是一片佈滿探針的電路板，為測試機台和待測晶圓間測試分析的介面；晶圓製作完成後，需要透過探針卡測試晶圓品質，檢測出品質優良、或不良(瑕疵或故障)的 IC (integrated circuit, 晶粒)；後續封裝流程中，只有品質優良的 IC 進入封裝程序，而品質不良的 IC 則避免封裝造成不必要的成本浪費。

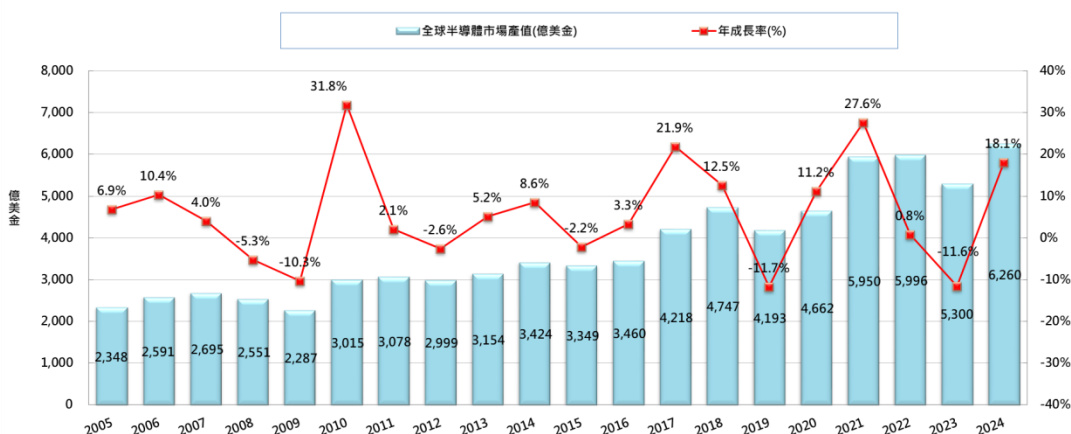
每一種類型的 IC 至少需一片相對應之探針卡。探針卡的工作原理係藉由設置於探針卡上的探針(probe needles)與待測晶片(Devices Under Test, DUT)上的錫墊(pad)或凸塊(bump)接觸進行針測(Probe test)，輸入及輸出晶片訊號以進行電性量測，再配合周邊測試儀器與軟體控制達到自動化量測。

晶圓經針測之後，晶圓依晶粒為單位切割成獨立的晶粒，再讓合格的晶粒繼續進到後段 IC 封裝製程，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，可保護晶粒以免受汙染，並有助後續裝配流程，達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。由於 IC 封裝的成本在整體 IC 生產上所佔比例較高，故避免不良晶粒進入後段封裝製程，可顯著地控制構裝成本、避免不必要的浪費。

伴隨電子產品朝向薄型化、高效能及低功耗方向，未來高階封裝的成本勢必提高，是以減少構裝浪費的晶圓針測技術已經成為 IC 產業中重要的一環。

台灣 IC 封裝與測試產業穩坐全球之冠，隨著 AI、HPC 應用興起，台灣 IC 封裝與測試業者持續布局高階封裝與異質整合技術，拉大與競爭業者之差距；在此同時，探針卡供應商及測試設備廠無不兢兢業業地跟隨趨勢，開發新技術，以持續維持領先地位。

全球半導體市場預測



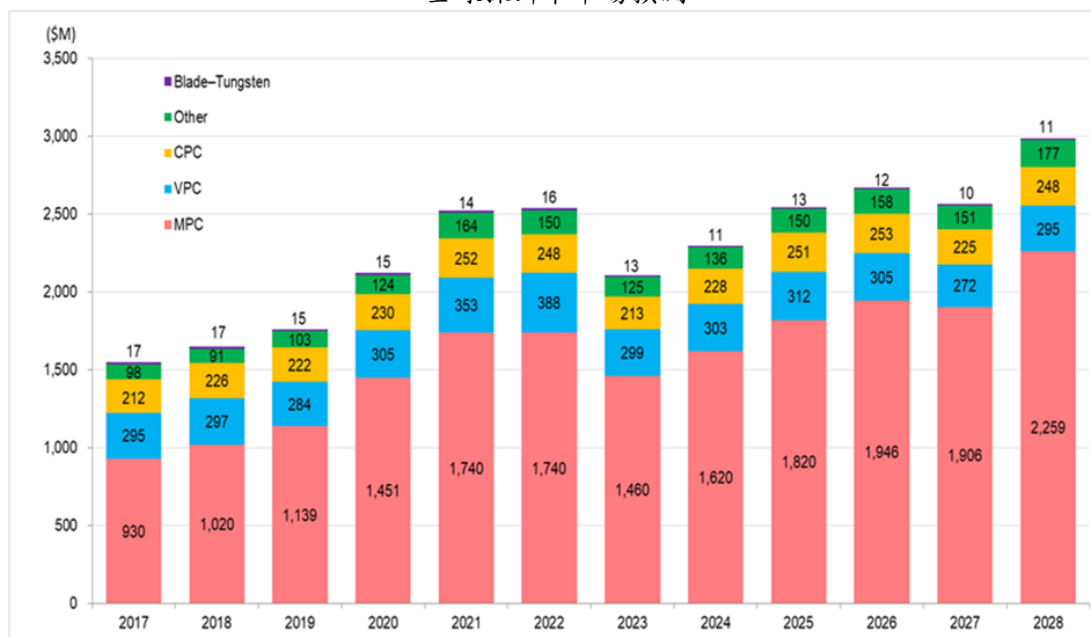
資料來源：Gartner (2025/02)；旺矽彙整

由於晶圓探針卡與半導體產業息息相關，半導體市場的興衰影響晶圓探針卡的市場。根據市調機構 Gartner 調查報告資料，2024 年全球半導體營收達到 6,260 億美元，較 2023 年成長達 18.1%，主要為 AI 和生成式 AI 需求成長帶動下，資料中心用的繪圖處理器(GPU)及人工智慧(AI)處理器扮演半導體產業的關鍵驅動力。

工研院產科國際所於 2024 年 12 月發表的預估報告表示，電子終端需求逐漸恢復正成長、加上 AI 與 HPC 應用帶動先進製程需求，2024 年整體半導體市場表現亮眼。隨著全球經濟復甦、終端市場買氣逐漸回溫、人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)等需求提升，對於先進製程有強勁需求，是未來驅動半導體產業發展的主要推動力，全球半導體市場將在 2025 年恢復成長趨勢，年成長率達 12.5%，市場規模預估可達 6,874 億美元。

台灣半導體產業鏈在全球地位重要，半導體先進製程領先全球，晶圓代工、封裝測試產值全球 第一，IC 設計全球第二。2025 年台灣將先進製程技術引領 AI、5G 及高效能運算領域發展，推動台灣半導體產業邁向新高峰，產值預估突破 6 兆元台幣，相較 2024 年增幅將達 16.5%。

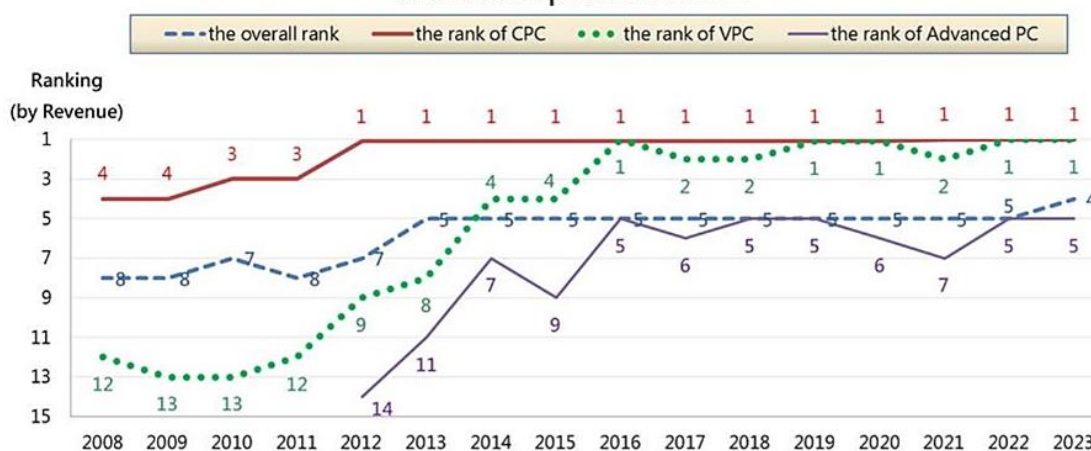
全球探針卡市場預測



資料來源：TechInsights(2024/05)；旺矽彙整(2024/05)

引用 Techinsights 2024 年 5 月公布的全球探針卡市場預測，2023~2028 年複合成長率(CAGR)為 7.2%，全球探針卡市場仍呈現穩定成長的樣態。

旺矽科技於全球探針卡市場之排名
the relative position of MPI



資料來源：TechInsights(2024/05)；旺矽彙整(2024/05)

TechInsights 2024 年 5 月公布的供應商調查報告，數據顯示旺矽科技自 2013 年躍升全球探針卡供應商總排名第 5 位之後，持續投入資源研發與拓展銷售，力求維持此一成績，並期望能以更優異的排名成績前進。旺矽科技在 2023 年全球探針卡總排名攀升至第 4 位；其中在懸臂式探針卡(Cantilever Probe Cards)市場中，旺矽全球市佔率排名第 1；在垂直式探針卡(Vertical Probe Cards) 市場中，旺矽全球市佔率排名第 1；在邏輯 IC 測試探針卡市場中，旺矽市占榮登全球第 3 名。

旺矽科技近年來無論是探針卡產值、抑或是全球排名方面，均逐年穩定向上攀升，在市場上已然奠定其領先地位；經營策略著重在研發投入及技術創新性，力求以更高階的技術持續其成長動能，以保有競爭優勢。

(b) 半導體設備

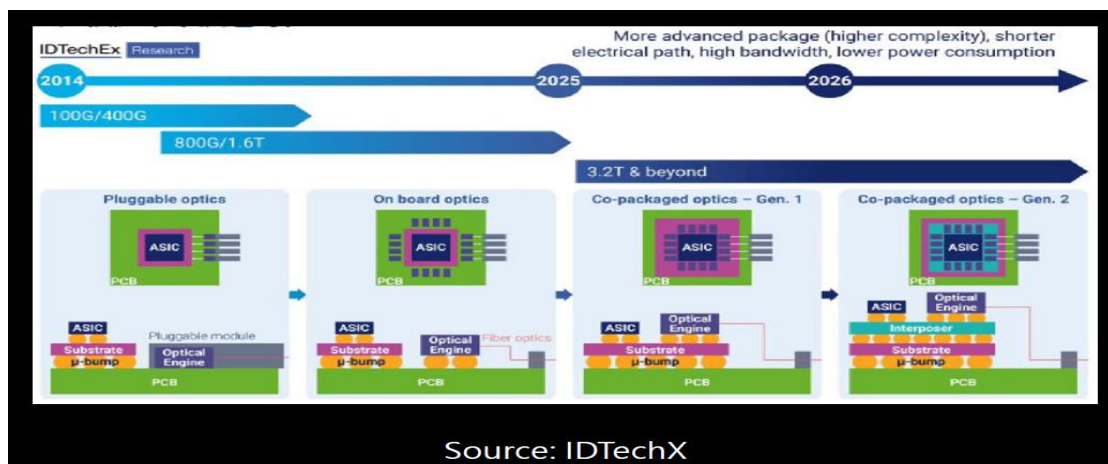
近年來國際產業的發展趨勢，環繞與 AI 相關的應用，已經成為主要的方向之一。Micro LED 除了應用在大型顯示器之外，隨著技術的突破，應用在車用顯示器的需求更加具體化，以及 AR 眼鏡全彩化方案日漸成熟，預計將帶動 Micro LED 晶片產值逐年成長。



Micro LED晶片產值預估(單位：百萬美元)。

(來源：TrendForce)

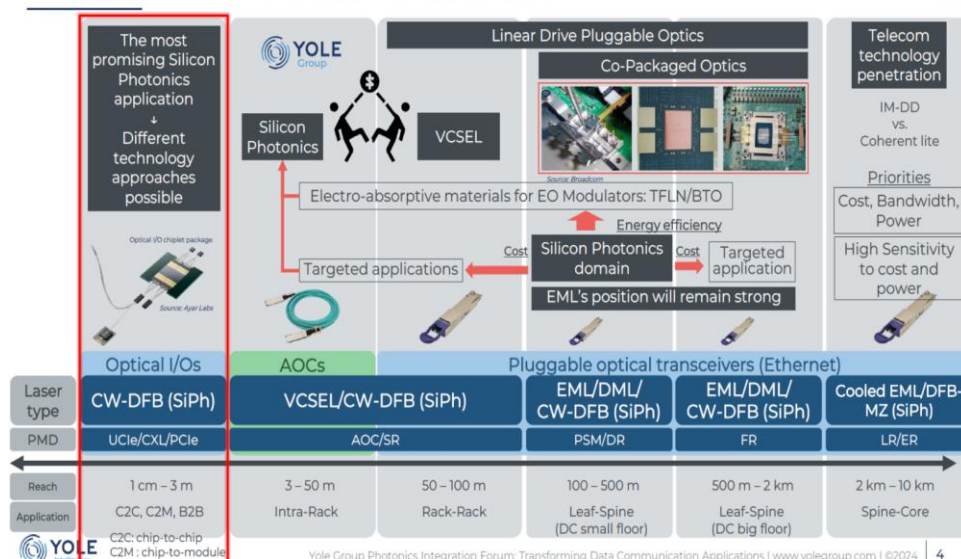
在過去兩年，AI 人工智慧對科技趨勢的深遠影響不容忽視，AI 快速發展已再次重新塑造全球半導體與科技產業，尤其是 AI 驅動的雲端與邊緣運算，以及光通訊技術的加速疊代等，都是未來看好的新興趨勢。AI 應用的深化將改變日常產品形態，例如更智能的手機、筆電和穿戴設備等。其中 AI 代理 (AI Agent) 的使用值得關注。此技術具備感知環境、決策與執行任務的能力，未來整合支付系統，讓人類願意使用將是一大里程碑。光通訊與交換器領域因 AI 應用普及，數據傳輸需求大幅上升，Server 之間的資料傳輸規格從 400G 迅速升級至 800G 甚至以更快的腳步邁向 1.6T，產品疊代速度顯著加快。由於光通訊產業不僅規格升級周期縮短、整體產業市場規模更是大幅提升，因此看好光通訊與交換器產業火熱趨勢持續。延續市場的趨勢，AI 應用使得未來電信與資料中心之數據傳輸量暴增，但資訊的傳輸效率卻無法跟上存算技術，如何優化網路傳輸效能已經成為另一不可忽視之因素。從目前市場已經成熟的 400G 規格，2024 年下半年已經開始導入 800G 的應用，未來更將朝向 1.6T，乃至 3.2T 的高速光通訊傳輸能力，以因應大型資料中心的蓬勃需求。



上述所提到的資料中心，所使用的光通訊元件，主要是以“機櫃到機櫃”（Rack to Rack）之間的光模塊傳輸模組。而過去一年光通訊領域的顯學：共封裝光學（CPO, Co-Packaged Optics），則提供了“元件到元件”（Device to Device）高速光通訊傳輸的應用介面。在光通訊應用的推波助瀾下，相關的光通訊元件如：VCSEL、CW-DFB、EML、DML 等主動式發光元件，未來的成長可期。

在高速資料中心的快速興起時，電力的大量消耗也將會是需要解決的課題之一。Micro LED 具有低功耗、壽命長等優點，預期未來也可以應用在高速的光通訊元件產業中。結合台灣已經很成熟的半導體、面板、LED 等產業，加快光通訊市場成熟的時程。

RECENT TRENDS IN DATACOM APPLICATIONS



資料來源：Yole 2024 研究報告

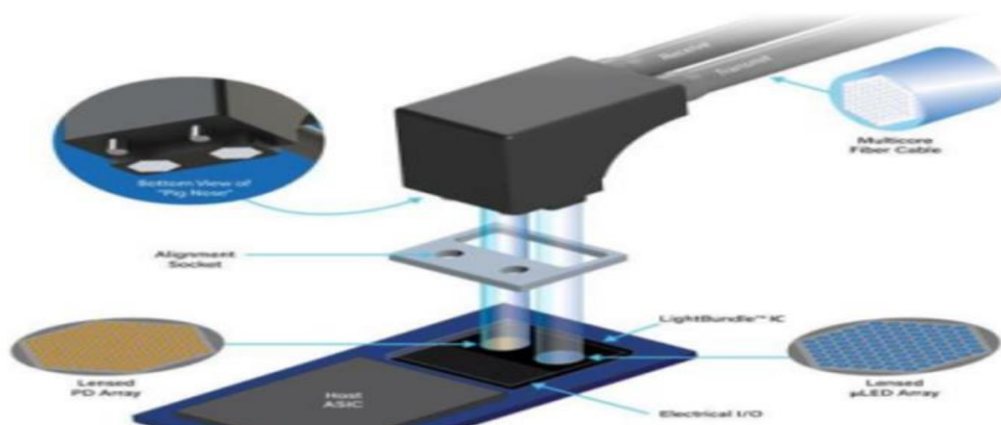


Fig 1a: LightBundle architecture

資料來源：Avicena ECOC 2023 Market Focus

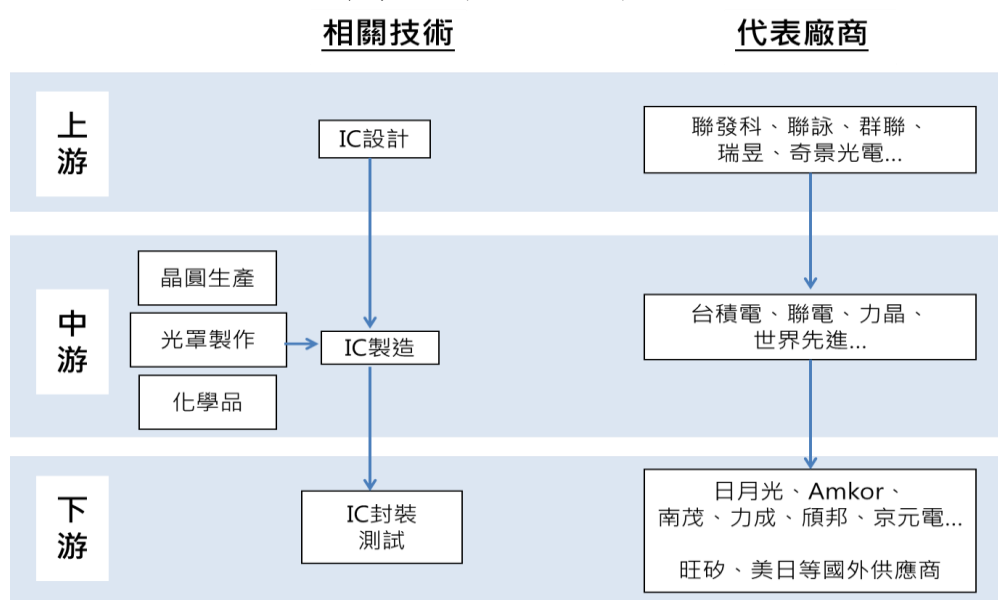
(2) 國內行業現況

(A) 晶圓探針卡(半導體產業)

半導體產業目前已是台灣重要的產業之一，在政府的推動以及業界多年的經營，形成半導體產業的完整供應鏈；台灣擁有完整產業結構以及專業分工體系，舉凡自上游的 IC 設計、中游的晶圓製造及下游的 IC 封裝、測試等，都有專業廠商投入。

2024 年台灣半導體產業受惠於 AI 新興應用及全球經濟復甦等，整體皆加速成長。IC 設計業隨著智慧型手機、AI PC 產品上市，通訊技術升級帶動設備升級，終端消費市場需求回溫。在晶圓代工表現，AI 與 HPC 應用帶動晶圓代工的營收成長強勁。IC 封測產業呈現穩定回升，AI 領域對先進封測技術的需求強勁，成為推動封測業的重要力量。

半導體產業上中下游關聯圖



資料來源：旺矽

根據工研院產科國際所的統計，2024 年第 3 季台灣整體 IC 產業產值（含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試）達新台幣 13,840 億元，較第 2 季成長 9.0%，較 2023 年同期成長 24%。其中，IC 設計業產值為 3,256 億元，較第 2 季成長 4.2%，較 2023 年同期成長 13.1%。而 IC 製造業為 8,965 億元，較第 2 季成長 11.1%，較 2023 年同期成長 32.7%。

資料顯示，2024 年第 3 季 IC 製造業的晶圓代工產值來到 8,508 億元，較第 2 季成長 11.9%，較 2023 年同期成長 34.7%。記憶體與其他製造為 457 億元，較第 2 季衰退 1.9%，但較 2023 年同期成長 3.9%。而另外，IC 封裝業為 1,114 億元，較第 2 季成長 9.0%，較 2023 年同期成長 7.6%。IC 測試業則為 505 億元，較第 2 季成長 4.3%，較 2023 年同期成長 3.1%。

預估 2024 年台灣 IC 產業產值達 5 兆 3,001 億元，較 2023 年成長 22.0%。IC 設計業產值為 1 兆 2,769 億元，較 2023 年成長 16.5%。IC 製造業產值則是來到 3 兆 3,957 億元，較 2023 年成長 27.5%。

IC 製造業的晶圓代工產值，預估 2024 年達 3 兆 2,137 億元，較 2023 年成長 28.9%。記憶體與其他製造為 1,820 億元，較 2023 年成長 7.0%。另外 IC 封裝業為 4,270 億元，較 2023 年成長 8.6%。IC 測試業產值則為 2,005 億元，較 2023 年成長 5.2%。

表、2024 年台灣 IC 產業產值

億新台幣	24Q1	季成長	年成長	24Q2	季成長	年成長	24Q3	季成長	年成長	24Q4(e)	季成長	年成長	2024 (e)	年成長
IC 產業產值	11,667	-3.0%	15.7%	12,702	8.9%	25.1%	13,840	9.0%	24.0%	14,792	6.9%	22.9%	53,001	22.0%
IC 設計業	3,002	0.1%	25.1%	3,125	4.1%	16.4%	3,256	4.2%	13.1%	3,386	4.0%	12.9%	12,769	16.5%
IC 製造業	7,193	-4.3%	14.6%	8,071	12.2%	32.9%	8,965	11.1%	32.7%	9,728	8.5%	29.4%	33,957	27.5%
晶圓代工	6,749	-4.8%	14.9%	7,605	12.7%	34.7%	8,508	11.9%	34.7%	9,275	9.0%	30.8%	32,137	28.9%
記憶體與其他製造	444	4.0%	9.4%	466	5.0%	8.9%	457	-1.9%	3.9%	453	-0.9%	6.1%	1,820	7.0%
IC 封裝業	987	-4.1%	5.0%	1,022	3.5%	10.2%	1,114	9.0%	7.6%	1,147	3.0%	11.5%	4,270	8.6%
IC 測試業	485	-0.6%	4.3%	484	-0.2%	4.5%	505	4.3%	3.1%	531	5.1%	8.8%	2,005	5.2%
IC 產品產值	3,446	0.6%	22.8%	3,591	4.2%	15.4%	3,713	3.4%	11.8%	3,839	3.4%	12.0%	14,589	15.2%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,112	16.0%

註：IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業產值

資料來源：工研院產科國際所(2024/12)

2025 年在全球人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求持續攀升，應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景。台灣具備全球最先進封測能量及晶片異質整合封測技術，能滿足全球電子終端產品所需晶片高整合及高效能需求等優勢。IDC 預估 2025 年，全球半導體封測將成長 9.0%，對於仰仗半導體封測業的探針卡產業而言，終端應用衍生的高階封裝需求激增，封測需求穩定成長，可望刺激探針卡市場需求持續增長。

(B) 半導體設備

在全球半導體產業的供應鏈中，台灣一直扮演著重要的代工與製造的角色，即使在美中貿易戰火持續之下，台灣仍舊全球最關鍵的半導體生產基地。AI 應用所帶動的產業，從上游的 IC 設計，到中游的晶圓代工製造，以及下游的 2.5D 或是 3D 的封裝產業。在光通訊業界的需求，也包含了光纖陣列 (Fiber Array)，以及主動發光元件如 VCSEL、CW-DFB、EML、DML、Micro LED 等，這些也都是台灣產業的強項。在新應用帶動更高技術的產品的同時，相關的自動化導體設備的需求，也會逐漸的蓬勃興起。

本公司一直持續的專注於各式半導體元件製程中所需要的各種工程與量產設備的開發與應用，除了在傳統的晶圓等級的測試與分選設備提供完整的製程解決方案外。同時也積極的與國際技術領先廠商相互合作，開發各式半導體量產製程中所需的檢測設備。隨著 VCSEL、LiDAR、Silicon Photonics、Micro LED 等光電感測元件應用的興起，本公司全力的與技術領先的國

際大廠及學術單位合作，在充滿挑戰的環境中，不斷的精進相關的核心技術，隨著產業的不斷的進步而不斷的成長。

(B) 產業上、中、下游之關聯性

本公司目前之主要產品包括晶圓探針卡及半導體設備系列機種設備等，由於機械業加工過程複雜，所需零組件數量眾多，故於生產過程中部分零件加工係由協力廠商負責製造。就其所屬行業上下游關聯情形觀之，本公司係研發、設計組裝並銷售各式晶圓探針卡及機械設備予半導體及 LED(發光二極體)等產業之下游廠商，而上游則為零組件及原料供應體系，包括 PCB、探針、顯微鏡、滑軌及自動控制元件等供應商，茲將其產業相關之上、下游關聯性列示如下：

A. 晶圓探針卡：

上游	中游	下游
量測儀器業		
印刷電路板業	測試用探針	IC 設計產業
陶瓷板業	專用治具設備	IC 製造產業
合成樹脂製造業	晶圓探針卡測試設備	IC 測試產業
被動元件業		

B. 半導體設備：

上游	中游	下游
PCB 業	電腦	LED 產業
機械加工業	自動控制測試治具及設備	光電製造業
自動控制元件	探針	分離式元件業
量測儀器業		通訊業
電腦設備業		半導體晶圓測試產業
光學元件		
電子零件		

(C) 產品之各種發展趨勢

(1) 晶圓探針卡(半導體產業)

探針卡的發展與 IC 產業的電子封裝發展有高度關聯，目前如系統級封裝(System in Package, SiP)、立體封裝(InFO、CoWoS、2.5D & 3D IC Packaging)、扇外型封裝(Fan Out Packaging)、微機電與感測元件封裝(MEMS and Sensor Packaging)、矽光子、高頻測試等需求，均需仰賴不同的探針測試技術。IC 產業中對於封裝與測試階段的成本要求嚴謹，且伴隨 IC 製程技術演進，封裝與測試階段的技術要求也愈趨嚴苛。

歸納出以下九項發展趨勢：

①針距細微化

半導體整體技術的演進，將持續朝電路間隔微小化前進。配合未來 IC 製程微縮及晶片面積持續縮小，構裝接合技術追求最短連接長度、最佳電氣特性、高輸出/輸入接點密度，以縮小 IC 尺寸，增加單位晶粒數量；晶圓探針卡勢必朝向更細微化之針距發展，以符合 IC 製程技術的要求。

②處理高速訊號干擾

晶片系統級封裝 (System in Package, SiP) 以及多晶片堆疊構裝系統已成為 IC 發展主流，SiP 封裝的成本仍高，因此多晶片堆疊封裝前，必須確認單一晶片良率無礙，以及堆疊的各種晶片都經過針測，確保良率後再行構裝，以避免後續額外支出。此些晶片系統級封裝 (System in Package, SiP) 以及多晶片堆疊構裝當中的高速訊號需處理相關訊號整合及電磁干擾問題(signal performance)，技術難度逐漸提升。

③處理熱效應問題

IC 產品適用的工作環境各不相同，故晶圓測試時，必須模擬產品使用環境(高低溫)進行測試，以確認溫度的衝擊不會影響 IC 產品電子電路的正常運行。

數款晶片測試時都需考慮熱效應或高低溫測試問題。High performance 晶片衍生的熱效應問題在晶圓測試階段、以及後段封裝階段影響甚鉅；此外，車用晶片需求漸增，也凸顯熱效應問題的重要性。有些類型晶片需要更長的晶圓測試時間、更複雜的晶圓測試環境，使得探針卡設計必須考慮到晶圓測試時的增溫、降溫問題與限制，及溫度效應造成的探針卡變異現象。

④高頻高速探針卡

高速 SerDes 介面(high speed SerDes interface)應用漸增，面對此類光纖傳輸通訊界面測試，光纖對位精度要求嚴謹，光通訊所需的測試也需仰仗新的測試方法。探針卡須開發新的設計，以克服目前光通訊測試面臨的瓶頸。

5G 通信、車用電子、VR 無線傳輸、網路應用需求上揚，使高速通訊晶片需求大幅成長，甚至驅動 IC 也朝高速訊號傳遞發展。高速通訊晶片中最重要設計考量乃訊號之傳遞，所以訊號傳遞路徑的阻抗匹配、及訊號完整性都極其重要；如何進行探針卡的線路設計與製造精密度，以確保訊號傳遞之完整性，亦為探針卡的開發關鍵。

⑤多晶片平行測試

為節省測試時間與提升成本效益的一次接觸多晶片測試的策略，使得探針卡的設計難度激增。此外，要達到多晶片平行測試目的，設計晶片同測數要高，同測面積要大，並且達成 DUT 與 DUT 間的一致性，控制良好平面度… …等，這些需求都須仰賴更好的探針卡設計製造技術。

⑥適用不同半導體材質與技術

對於半導體新製程技術的創新與開發，將衍生對應出不同類型的晶片焊墊 (Bonding Pad) 及焊墊材質。若待測晶片之接觸焊墊材質不同，所需之探針卡技術亦將有所差異。

⑦低接觸電阻

為符合手持行動裝置減少耗電的需求，其操作電壓相對應會降低，而探針卡在測試晶片時的接觸電阻就不能太高。因此低接觸電阻探針卡，亦為設計開發之要點。

⑧少清針

探針卡的針尖接觸品質不佳時，將無法達到良好測試功能，必須加以清針才能繼續測試；但清針時，針尖會被磨耗，探針壽命會因此縮短。因此開發少清針之探針卡已成產品發展重點。

⑨高功率晶片測試

工業、通訊與網通設備市場對於高功率、高電壓的電源晶片需求迅速攀升，促使 IC 廠商廣泛布局相關產品；工業、通訊、網通設備對於高功率電源晶片需求的共通點在於高輸入電流，故開發適用於高功率晶片測試的探針卡，就非常重要。

(2) 半導體設備

①光電性高速量測能力

VCSEL、CW-DFB、EML、DML、Micro LED 等主動式光通訊元件，生產製程中的量測，除了一般的光性與電性量測外，在量測更高速與更高頻率的元件射頻特性時，設備的穩定性與抗雜訊的能力，要求也都比過往的標準提高不少。

此外，在 VCSEL 元件應用於 LiDar 等車載環境時，需要輸出大功率來進行遠距的地形地物偵測，因此在晶圓等級量測時，奈秒脈衝 (nano second pulse) 以及高電流，是必要的測試條件。結合了高速的量測系統，以及高電流驅動 IC 的探針卡，將會是下一階段技術發展的方向。

②光學耦合精密度

量測矽光子元件的光纖陣列(Fiber Array)，精密的光學耦合能力 (optical coupling capability) 也要能精準地控制到毫米能力，才能完成矽光子元件中的光波導管特性量測。同時 CPO 元件測試時，需要用到微間距 (fine pitch) 的微凸塊 (micro bump) 點測能力，對於機台的精密定位能力，以及微間距的垂直式探卡製作技術，都是一大挑戰。

③自動化生產

目前人力的生產成本不斷的攀高，光電元件產業的生產也逐步開始比照半導體產業，需要導入大量的自動化生產設備與流程。多站點分散式測試設備提供了在最小的空間內，

產能最高的系統，同時可以與無人化工廠的晶圓自動傳輸結合，達成最高效能的生產需求。

④生產管理

除了單站機台的產出效率外，整線的產出效率，也是各廠重要指標。如何結合資料流及最有效率生產製程，機器的應用設計，也必須不斷的演進。

(D) 產品之競爭情形

主要競爭對手名稱及其營業項目或競爭項目

(1) 晶圓探針卡

根據 TechInsights 調查，旺矽科技為國內專業晶圓探針卡龍頭製造商，在台灣探針卡供應商當中，旺矽科技是唯一名列前四名的探針卡廠商。主要競爭對手是來自於國外之大廠。

同業廠商	競爭產品
台灣傑睦股份有限公司（日商 JEM 在台設立）	晶圓探針卡
美亞科技股份有限公司(Nidec SV TCL 集團之台灣分公司)	晶圓探針卡
美商福達電子股份有限公司(美商 FormFactor 分公司)	晶圓探針卡
特諾本科技有限公司(義大利商 Technoprobe 集團之台灣分公司)	晶圓探針卡

(2) 半導體設備

本公司的半導體設備率先以自有品牌與卓越技術能力，取得客戶的高度認同。隨著光電產業逐漸的成長，越來越多國產設備廠商投入相關的半導體設備開發。本公司憑藉著自有技術能力、以及顧客至上的服務精神、搭配充沛產量的支援，在如此高度競爭的市場仍能保持第一領導品牌的地位。茲就相關競爭廠商說明如下：

同業廠商	競爭產品
OPTO tech. Co., Japan	晶圓針測機 晶粒挑揀機
惠特光電股份有限公司	晶圓針測機
致茂股份有限公司	晶圓針測機
Cascade, USA	晶圓針測機
豪勉科技	晶圓針測機
維明科技有限公司	晶圓針測機 晶粒測試儀
矽電科技, 中國	晶圓針測機
柯泰科技, 中國	VCSEL 測試系統
菲萊科技, 中國	VCSEL 測試系統

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日
-----	--------	-------------------

研發費用	1, 089, 293	268, 562
------	-------------	----------

2. 最近五年度開發成功之技術或產品

年 度	技 術 或 產 品 名 稱
113	AI 晶片之高速測試用探針卡(224Gbps PAM4)開發計畫 應用於高效能運算處理器 IC 測試之高針數微機電探針卡開發計畫 高精度、高抗震 AVI 檢測平台 高速 PAM4-100G 元件光電射頻特性量測系統 皮安等級 (pico level)光強度、低電流量測系統 晶粒等級 (chip level)與封裝體(package level)矽光子元件測試與自動化挑檢系統
112	應用於高階智慧型手機應用處理器 IC 測試之大面積、高針數微機電探針卡開發計畫 車用 IC 測試之大面積微機電探針卡開發計畫 高效能運算 IC 之高速測試用探針卡(112Gbps PAM4)開發計畫 奈秒脈衝等級之高功率雷射二極體 (Laser Diode、VCSEL) 之晶圓級測試系統 化合物半導體量產自動化設備
111	先進 CoWoS 封裝之資料中心(HPC)應用處理器測試用垂直式探針卡開發計畫 微間距(70um)全陣列微機電垂直式探針卡開發計畫 自動可調探針間距之高階載板阻抗測試設備開發計畫 Micro LED 多通道高速低電流量測設備 奈秒脈衝等級之高功率雷射二極體 (Laser Diode、VCSEL) 之晶圓級測試系統 化合物半導體量產自動化設備
110	微間距(80um)全陣列微機電垂直式探針卡開發計畫 低階測試機實現高速訊號(≥ 2.5 Gbps)測試之高速模組探針卡開發計畫 結構強化微間距垂直式探針卡開發計畫 8 吋 Micro LED 晶圓級多站點分散式光電測試系統 奈秒脈衝等級之高功率雷射二極體 (Laser Diode、VCSEL) 之晶圓級測試系統 新世代情境式使用者體驗操作介面
109	先進垂直式探針卡(FW)開發計畫 低/中/高頻訊號(Hybrid Pogo)測試用探針卡開發計畫 高階載板阻抗測試之可調式探針裝置開發計畫 Micro LED 晶圓級高速光電量測系統 高速高電流大功率雷射二極體 (Laser Diode、VCSEL) 之晶圓級測試系統 三溫全自動探針台，晶圓級與 PCB 級的光電量測系統

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 長期業務發展計畫

- (1) 開發美國市場，以支援客戶之需求
- (2) 應用累積之技術及人才向電子測試領域做水平發展
- (3) 培育國際化分工產銷之人才與能力
- (4) 持續多方面改善企業體質
- (5) 催化國內薄型化晶片應用

- (6) 未來料源充足時，延展長晶廠之業務觸角
- 2. 短期業務發展計畫
 - (1) 強化人才培訓
 - (2) 市場拓展行銷
 - (3) 建立各部門日常管理制度，落實部門管理

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區以台灣為主，其他銷售地區也擴及美國、日本、歐洲及中國。目前國內主要的晶圓代工廠商(Foundry)、IC 設計公司(Fabless)與封裝測試廠(OSAT)都是本公司客戶。

2. 市場占有率

旺矽科技專精於半導體晶圓測試用探針卡設計與製造，為國內第一大廠，跟國內同性質競爭業者相較，舉凡產能、研發製造能力、財務結構均最完整。

國際專業市調機構 TechInsights 於 2024 年 5 月公佈的 2023 年全球晶圓探針卡調查報告中指出，於全球探針卡公司總排名中，旺矽科技位居全球排名第 4 位；在懸臂式探針卡以及垂直式探針卡市場中，旺矽科技更是穩坐全球第 1 大探針卡供應商。

在國內，旺矽科技乃探針卡市場之業界龍頭，產品內容涵蓋整體探針卡、懸臂式、垂直式、LCD 驅動 IC、高頻高速、微機電探針卡，且無論是品質或是銷售量，皆為國內同業之指標。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 需求方面：

台灣產業聚落完整，上下游供應鏈完善，是台灣半導體業的競爭優勢。在 IC 構裝體積日漸縮小，構裝成本提高的趨勢下，晶圓針測已是 IC 製程中重要關鍵的一環，故晶圓探針卡需求量與 IC 製造量之間有一定相互關係。

近年來由於各式消費性電子產品的功能愈複雜及多樣性，加上 5G 通訊、高效能運算(HPC)、汽車/工業與 AI 等應用領域發展趨勢，使得消費者除了要求各項產品要輕、薄、短、小之外，對於功能性的需求愈高；國內外半導體市場之領導廠商為提高產業佔有率，仍持續增加資本支出，擴充產能；隨著晶片量產數量的提升，加上晶片之封裝技術趨勢朝向薄型化、低系統成本、高效能發展，對於晶圓針測的要求也越趨嚴謹。

台灣晶圓代工業位居全球第一，台灣封測業高居全球第一，IC 設計業居全球第 2，僅次於美國；半導體產業聚落完整已然是台灣半導體業的競爭優勢。

封測業與 IC 製造、IC 設計業同步成長，都是驅動台灣半導體產業不斷成長的動能。由於探針卡主要應用於晶圓良率檢測，晶圓代工業的發展可期，預計也將激勵探針卡市場的成長。而探針卡的設計越益複雜，更加重半導體產業對於探針卡的品質與數量之需求。

(2) 供給方面：

全球探針卡市場高度競爭，各探針卡廠商有其專精擅長的產品技術與合作的客戶，例如國外某些廠商對於記憶體掌握度較高。在國內市場已是龍頭地位的旺矽科技則專精於懸臂式、LCD 驅動 IC、垂直式和高速高頻率的探針卡，目前國內大部分廠商均已是旺矽長期合作的客戶，旺矽科技駐足台灣、關注台灣產業技術變化之外，也積極布局國外各主要區域，力求探針卡產品可滿足市場需求。

技術能力方面，旺矽在高腳數、狹間距、高速高頻率的製作技術已相當成熟，居市場領先地位，並已建立一定的技術門檻；探針卡產品包含懸臂式(Cantilever)、垂直式(Vertical)和微機電式(MEMS)探針卡，不論是一般型或高頻測試用探針卡，旺矽科技已具備能力可自行提供，加上產品兼具微間距、同測數高的優點，可節省晶圓測試成本、提升針測精準度。旺矽未來仍將秉持技術創新的理念，持續投入下一代的高階先進式探針卡的研發工作。

4. 競爭利基

- (1) 提供卓越穩定的技術與產品，多年來已與客戶培養穩定之合作關係。
- (2) 提供 Total Solution，搭配即時客戶服務與相關領域的應用 Know-how。
- (3) 持續創新：面對技術不斷提升的科技產業，滿足產業對新技術的應用與需求，旺矽科技除了持續投入相當多的研發資源進行技術研發以確保領先地位之外，近年都投入大量之研發經費做技術開發，特別是新技術之開發，以確保公司未來之競爭力，打造技術壁壘。在先進式垂直式探針卡市場，目前已直接跟國外 IC 設計公司接洽，從中建立起緊密合作關係，並投入大量研發資源，以確保未來之成長性。
- (4) 完整的專利佈局：提出申請的專利數共計 1,492 件，獲證(公開)之專利權共 1,073 件(統計至 2024 年底)。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- (a) 產品品質及穩定性已獲國內外半導體大廠之認可，目前已成功打入國際大廠供應鏈，更是國內公認最佳供應商。
- (b) 具備完整、多元的研發能力和人才，對於未來產業之趨勢發展，能做審慎、完整的佈局。
- (c) 市場需求日漸趨向高腳數、狹間距與高速傳輸訊號的設計，本公司在此領域產品的品質和穩定性具高度競爭力，市場需求擴大，可望帶動本公司營收。
- (d) 完整的產品線：本公司以自動化的核心技術，不斷建立各項自動化應用技術。產品可因應需求，快速設計更換，適用於半導體產業中各相關產品測試，故可大幅降低單一產業景氣變動影響的風險。
- (e) 敏銳的市場掌握能力：擁有完整的銷售及服務通路，可即時反應市場狀況，作為回饋，確保競爭力。

(2) 不利因素

- (a) 小規模廠商為求生存而殺價競爭，增添市場價格變動的風險。
- (b) 傳統式晶圓探針卡市場成長有限，因此需持續開發微機電式、垂直式探針卡技術，以滿足先進式封裝大幅成長的需求。
- (c) 自動化測試設備的精密機械零件，大部分需自國外進口，取得成本高且交期長，在台灣客戶交期需求上存在風險。

(3) 因應對策

- (a) 提升晶圓探針卡製造品質，並縮短交期，以滿足客戶需求，爭取合理價格。
- (b) 積極投入資源進行技術研發，以因應新的技術挑戰，確保技術領先地位。
- (c) 加強測試設備之業務及市場研究，以提高對市場需求預估之準確性，並依市場需求，訂定進口零組件之安全庫存量，並建立半成品庫存制度，進而確保交期無虞。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

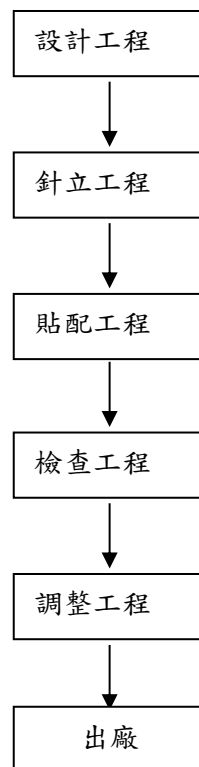
(1) 主要產品之重要用途：

產品或服務	主要用途或功能
晶圓測試用晶圓探針卡	晶圓測試階段的量測介面，為待測晶圓與測試機台之間的橋樑，廣泛應用於邏輯元件、記憶體元件及 LCD 驅動元件晶圓級測試。
LCD Driver IC Final Test 測試用晶圓探針卡	屬封裝後的測試介面，為待測 LCD Driver IC、Tape 與測試機台之間訊號傳輸的橋樑。
垂直式探針卡	晶圓測試階段的量測介面，針對晶圓級針測及覆晶式產品需求所設計。
微機電式探針卡	晶圓測試階段的量測介面，針對晶圓級針測及覆晶式產品需求所設計。

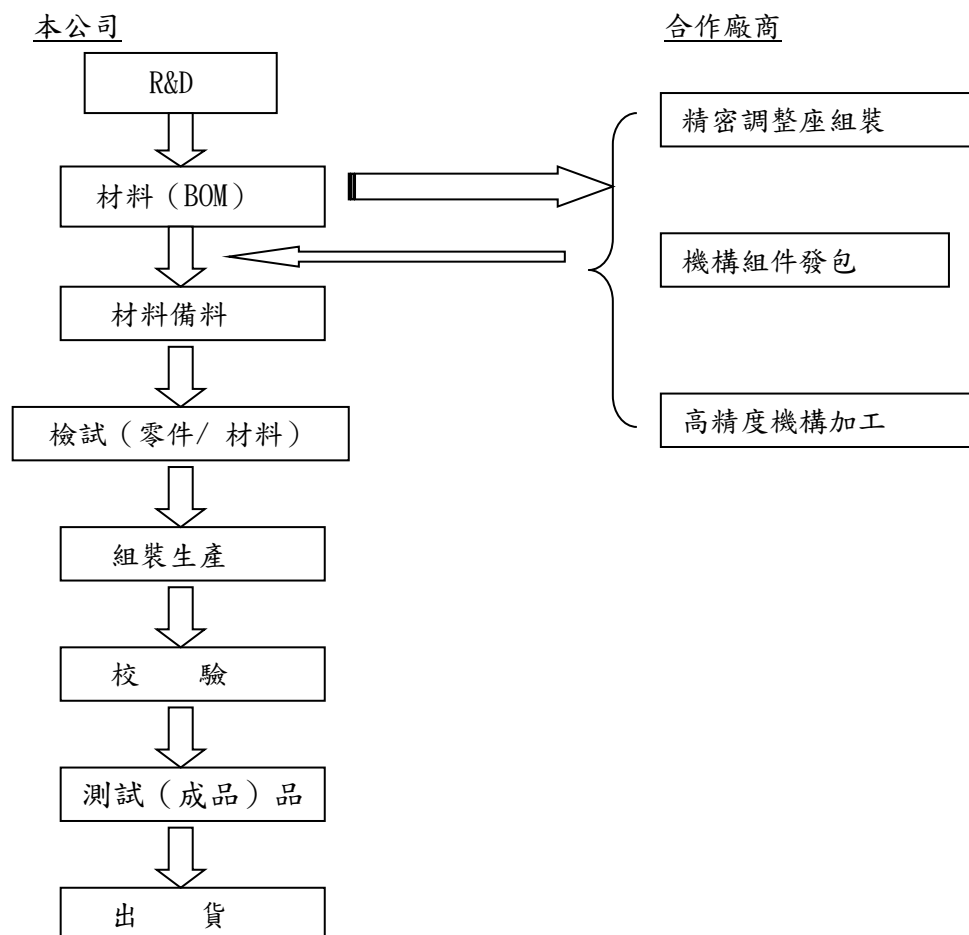
半導體晶粒測試設備	光電半導體晶圓製作完成後，測試晶粒之光電性特性，並進行資料分 Bin。
半導體晶粒測試分選設備	光電半導體晶粒測試完成後，依晶粒之光電性特性，進行分類挑檢用。
全自動 AOI 檢測設備	光電半導體檢測與分選後，以自動光學檢測 AOI 的方式，將外觀不良的晶粒與以標示與分類的設備。

(2) 產品之產製過程

(a) 晶圓探針卡



(b) 半導體設備



(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品分為晶圓探針卡及半導體設備，晶圓探針卡其所需之原物料為 PCB、探針、套管等；半導體設備其所需之原物料為顯微鏡、機械車床、機械銑床、螺桿軌道、馬達、工業電腦等，本公司與國內外原物料廠商維持良好之合作關係，且關鍵材料、零組件均維持兩家以上的供應商，以保持採購彈性及分散原物料過於集中之風險。

(四) 主要進銷貨客戶名單

(1) 最近兩年度佔進貨總額 10% 以上之廠商名單

單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
E 廠商	186,288	10.32%	非關係人	其他	2,346,002	100.00%	非關係人	其他	682,974	100.00%	不適用
其他	1,619,551	89.68%	不適用				不適用				
進貨淨額	1,805,839	100.00%		進貨淨額	2,346,002	100.00%		進貨淨額	682,974	100.00%	

增減變動說明：112 年度 E 廠商為超過進貨淨額 10% 之廠商；本公司 113 年度無佔進貨淨額 10% 以上之廠商。

(2) 最近兩年度佔銷貨總額 10% 之客戶名單

單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
其他	8,147,112	100.00%	不適用	其他	10,171,861	100.00%	不適用	其他	2,828,698	100.00%	不適用
銷貨淨額	8,147,112	100.00%		銷貨淨額	10,171,861	100.00%		銷貨淨額	2,828,698	100.00%	

增減變動說明：本公司 112 年度及 113 年度均無佔銷貨淨額 10% 以上之客戶。

三、從業員工資料

最近二年度及截至年報刊印日從業員工資料

年	度	112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 30 日
員工 人數	間 接 人 員	855	907	921
	直 接 人 員	826	942	989
	合 計	1,681	1,849	1,910
平 均 年 歲		38.2	38.1	38.1
平 均 服 務 年 資		9.43	9.33	9.26
學歷 分布 比率 (%)	博 士	0.30	0.32	0.26
	碩 士	17.25	16.98	17.02
	大 專	68.35	68.04	68.22
	高 中	13.68	14.06	13.98
	高 中 以 下	0.42	0.60	0.52

四、環保支出資訊

(一) 本公司通過環境管理系統(ISO14001)之驗證,有效期限為 2022 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 19 日,預計今年度完成三年重新驗證,最新證書效期預計為 2025 年 09 月 20 日至 2028 年 09 月 19 日。透過系統運作,檢視各流程對環境之影響,進而檢討及持續改善。公司設置支援服務部負責統籌、維護並持續改善環境管理系統,亦負責對外部及內部溝通環境之相關議題。由於公司產品特性,其製造過程對環境的衝擊甚微,主要的污染物類別為廢棄物及空污與廢水,惟公司重視各項污染防治工作,為減少環境衝擊,仍致力於投資設置污染防治設備,期使在有效管理下,使污染之影響日益減少,經由對各作業活動之盤查,以及同仁在活動過程之環保意識提升,建立年度改善計畫,進行廢棄物與空污與廢水的管控及減量,以達到污染預防、減少環境衝擊之承諾。

1. 依法令規定,應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者,其申領、繳納或設立情形之說明:
 - (1) 據環保法規,本公司竹北二廠、新埔廠及湖口廠申領取得水污染防治許可證及固定污染源操作許可證;並設有乙級廢水處理專責人員及甲級空氣污染防制專責人員。
 - (2) 依據環保法規辦理污染防治費用申報及繳費。
2. 公司有關防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益:污染防治設備用於製程廢水及廢氣之處理,減少環境污染、符合環保法令。
3. 最近年度及截至年報刊印日止,公司改善環境污染之經過,其有污染糾紛事件者,並應說明其處理經過:本公司最近年度及截至年報刊印日止並無環境污染情事。
4. 最近年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容),並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實:本公司最近年度及截至年報刊印日止並無此情事。
5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位或資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出:無。

6. 因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)相關資訊：依本公司行業特性，不受其影響，故不適用。

(二) 本公司使用能源有超過 95%來自外購電力，因此公司致力於電力減量，針對特定廠區之主要耗能設備如冰水主機等建立中央監控智慧節能系統，檢視其使用狀況與異常偵測，並配合政府節能政策，針對契約容量超過 800KW 的廠區設定年節電 1%的目標，近三年來達成平均節電率為 1.56%，節電總度數達到 87 萬度。

(三) 本公司 2022 年起推動組織溫室氣體盤查作業，並以 2022 年為基準年，於首年度建立本公司全廠區溫室氣體盤查管理制度，並於 2023 年 10 月完成 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查查證，後續規劃將配合政府政策研擬溫室氣體減量，以求達成排放減量目標。

五、勞資關係

(一) 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1) 員工福利措施：

本公司各項福利措施之擬定及推展，主要係為確保員工工作之安全與健康，藉由員工組成職工福利委員會之組織運作，使得同仁更樂於參與實際活動規劃與執行，促使各項活動更為出色、更為實際，以期達到調劑身心的目的。公司亦能體認員工係公司成長之重大動力，除上述組織運作辦理員工福利事宜外，另有相關福利措施如下：

- (a) 優渥的年薪，生活品質的提昇
- (b) 端午節、中秋節、年終獎金及三節禮券
- (c) 依工作績效給予員工酬勞，利潤共享
- (d) 定期依工作績效調薪
- (e) 依工作績效給予績效獎金
- (f) 提供國內外旅遊、購書、休閒娛樂活動等津貼
- (g) 優於勞基法之有薪彈性調整假
- (h) 公司自設餐廳，免費提供伙食，用心照顧同仁健康
- (i) 每年免費健康檢查，每月兩次專業醫生駐廠提供同仁免費健康諮詢
- (j) 提供宿舍補助、免費汽機車停車場、健身房、韻律教室等
- (k) 舒適的圖書空間並供免費借閱書報雜誌
- (l) 免費取用自助沖泡咖啡及茶包，代售優惠票券
- (m) 婚喪喜慶及生育補助
- (n) 完善教育訓練
- (o) 勞工保險、健康保險、團體保險、勞工退休金
- (p) 員工持股信託

113 年員工福利措施實施情形：

旅遊活動項目	補助人數	補助金額
員工旅遊補助	1,280 人	18,810,796 元

其他活動項目	參與人數
--------	------

牌藝大賽	140 人
30 周年圖騰設計	842 人
員工國內一日遊	424 人
粽情端午福氣抽獎	1,583 人
中秋禮盒	1,802 人
紅包袋	1,859 人
旺矜 30 周年聯合家庭日	2,413 人
聖誕福袋	1,741 人
年終尾牙	1,876 人

(2) 進修、訓練制度與其實施情形：

本公司由人力資源部的專門人員進行安排、規劃課程(包含公司委託其他單位、機關協辦之訓練課程)等專業職能的教育訓練，配合公司營運方針及發展目標，提升所有員工之素質、充實基礎知識、並增進工作技能，以發揮員工潛在之能力，及配合法令之宣導。公司教育訓練體系分為內部訓練、派外訓練、出國研習等，以滿足員工自我實現的個人需求。

113 年員工進修與訓練情形：

項目	班次數	總人次	總時數	總費用
1. 新進人員訓練	3	148	814	0
2. 專業職能訓練	227	1,909	8,977.9	2,721,729
3. 主管才能訓練	5	114	2,417	791,000
4. 通識訓練	166	8,058	15,919.5	412,530
5. 自我啟發訓練	14	381	1,228.95	398,703
合計	415	10,610	29,357.35	4,323,962

(3) 退休制度與其實施情形：

退休--適用選擇舊制者

本公司依政府相關法令按月提撥勞工退休準備金，並成立勞工退休準備金監督委員會，綜理有關退休作業事項。

同仁有下列情形之一者，得自請退休：

- 一、工作年資滿十五年以上，且年齡滿五十五歲以上者。
- 二、工作年資滿二十五年以上者。
- 三、工作年資滿十年以上，且年齡滿六十歲者。

員工有下列情形之一者，得強制退休：

- 一、年齡滿六十五歲者。
- 二、心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得由事業單位報請中央主管機關予以調整。但不得少於五十五歲。員工退休年齡之認定，以戶籍記載為準，自出生日起實足計算。

員工退休金之給予標準規定如下：

一、工作年資每滿一年給與兩個基數，超過十五年之年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。其餘年資，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。

二、依本規則第六十一條第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依前款之規定加給百分之二十。

員工退休金基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資；平均工資係指退休當日前六個月內所得工資總額除以六。

計算平均工資時，下列各款期間之工資及日數不列入計算：

一、員工退休之當日。

二、因職業災害尚在醫療中者。

三、女性員工到職未滿六個月因產假停止工作期間，其薪資減半發給者。

四、公司因天災、事變或其他不可抗力因素需停止，致員工未能工作者。

五、員工因普通傷病或留職停薪致薪資折半發給或不發給之期間。

退休金之給付應自員工退休之日起三十日內給付之。

勞工請領退休金之權利，自退休之次月起，因五年不行使而消滅。

其餘有關退休事項，依本公司員工退休辦法及勞動基準法規定辦理。

退休—適用選擇新制者

本公司依政府訂定之勞工退休金條例，按月提撥勞工退休金，並成立勞工退休準備金監督委員會，綜理有關退休作業事項。

勞工退休金之收支、保管、滯納金之加徵、罰鍰處分及其強制執行等業務，由中央主管機關委任勞工保險局辦理之。

勞退新制施行後，仍服務於本公司者，其適用新制前之工作年資，暫時予以保留，當勞動契約符合勞動基準法各項退休規定時，本公司依各法規定，以契約終止時之平均工資，計給該保留年資之資遣費或退休金。

本公司每月負擔之勞工退休金提繳率，不得低於勞工每月工資百分之六。

勞工退休金自員工到職之日起提繳至離職當日止。

員工留職停薪、入伍服役、因案停職或被羈押未經法院判決確定前，本公司應於發生事由之日起七日內以書面向勞保局申報停止提繳其退休金。

退休金之領取及計算方式如下：

一、94年7月1日後始到職或離職後再受僱者，依法均應適用勞退新制，年滿60歲（不限工作年資）即得向勞工保險局請領適用勞退新制期間個人專戶累積之退休金。

二、月退休金：勞工個人之退休金專戶本金及累積收益，依據年金生命表，以平均餘命及利率等基礎計算所得之金額，作為定期發給之退休金。

三、一次退休金：一次領取勞工個人退休金專戶之本金及累積收益。依本條例提繳之勞工退休金運用收益，不得低於當地銀行二年定期存款利率；如有不足由國庫補充之。

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
如何提撥	按員工每月薪資總額 2%提撥退	依員工每月薪資之投

	休基金，以勞工退休準備金融監督委員會之名義專戶儲存於臺灣銀行。	保等級提撥 6%至勞工保險局員工個人帳戶。
提撥金額	截至民國 113 年 12 月 31 日止，本集團撥存於臺灣銀行勞工退休準備金專戶之餘額為新台幣 121,617 千元。	民國 113 年度本集團提撥退休金為新台幣 100,744 千元。

(4) 勞資間之協議情形：

本公司屬勞動基準法適用行業，一切運作皆依勞動基準法為遵循基準，勞資關係和諧。

(5) 與員工權益維護措施：

本公司本著盈餘分享員工的理念，於章程上明訂員工分紅比率，以激勵員工參與熱誠。並設置「意見提案箱」推行提案制度，凡任何有助於公司管理或制度或設施等改進方法或意見皆可提議，為鼓勵員工踴躍提案，依其影響程度發給不等之獎勵金，以提供員工工作及生活上之溝通與意見交流的橋樑。

(6) 工作環境與員工人身安全保護措施：

建構安全環境，在大門出入口有 24 小時保全人員守衛，各出入口設有門禁管制及監視錄影系統，停車場設有緊急求援按鈕；建築物、消防器具、電氣設備、飲用水、電梯等各項設備，定期進行檢查及維護，以保障員工人身安全。

本公司通過職業安全衛生管理系統(ISO45001)之驗證，有效期限為 2022 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日，預計今年度完成三年重新驗證，最新證書效期預計為 2025 年 09 月 01 日至 2028 年 08 月 31 日。由勞工安全專責部門及人員規劃執行及監督相關作業、教育訓練及內外部的溝通。並依照職業安全衛生法，設置職業安全衛生委員會，定期每三個月召開會議，以落實員工之安全衛生管理，進而保障員工安全與健康。另訂有勞工安全衛生、緊急應變、承攬商安全衛生、勞工安全衛生工作守則等災害防止管理辦法，每個月辦理自動檢查及預防災變所必要之安全衛生教育及演練，以提升同仁對於工作環境的危害認知及緊急應變能力，並確保緊急應變計畫運作之執行的有效性。

對於工作場所中可能影響員工安全或健康之因素，公司亦定期安排清潔、消毒、作業環境測定與巡查，並且提供同仁每年享有免費的健康檢查、安排醫師到廠健康諮詢服務與辦理健康促進活動，讓員工擁有安全舒適的工作環境。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：由於本公司勞資關係良好，雙方溝通管道順暢，並無未來可能之糾紛支出。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

管理架構

本公司在總經理帶領下，成立資訊安全委員會及指派公司跨處室之資訊安全代表，致力於資安事項，並於 2015 年起取得 ISO27001 資安管理架構合格認證至今，目前證書有效期 113 年 11 月 16 日至 116 年 11 月 16 日，持續精進資安制度與資安防護工具。

113 年度執行情況，由總經理擔任資訊安全組織召集人，指派管理代表負責資訊安全管理系統運作，由管理代表向召集人與資訊安全委員會報告執行內容，包含年度資安管理系統運作執行狀況與計劃、以及其他建議或臨時動議。

113 年度專責資安人員定期召開資安會議 24 次(固定於每雙週向管理代表報告)，資安管理審查會議召開 1 次，董事會資安運作成效會議召開 1 次，審查資訊安全發展方向及策略，使資訊安全管理制度持續穩健運作。近期資安治理報告已於 114 年 1 月 14 日董事會報告在案。

資安政策

1. 確保公司營業秘密(Trade secret, Business secret)及重要客戶資料之機密性。
2. 確保核心營運作業之資訊應用及支援服務與設備之可用性與完整性。
3. 確保資訊安全管理機制之有效性及持續性

公司為確保企業之永續發展與履行客戶承諾茲訂立公司之資訊安全政策，作業程序及辦法，以健全資訊風險管理，強化資訊安全管理機制，落實資訊安全防護，提升資訊安全之水準，並使公司各處室相關人員及重要合作夥伴有所依循。

資安管理方案

資訊安全具體管理方案如下：

1. 資訊架構檢視

(1) 檢視對於持續營運所採取相關措施之妥適性

檢視相關措施之架構與維運機制是否存在單點失效之風險，及針對業務持續運作之妥適性進行風險分析，並提出資訊架構安全評估之結果與建議。

(2) 檢視單點故障之最大衝擊與風險承擔能力

評估衝擊是否在風險承受度內，研議與執行改善之方案。

2. 網路活動檢視

檢視設備之存取紀錄及帳號權限

檢視網路設備、資安設備及伺服器之存取紀錄、帳號權限之授予與監控機制是否符合內控作業規範；以最小權限原則清查該等設備之帳號權限及存取紀錄，識別異常紀錄與確認警示機制。

3. 網路設備、伺服器及終端機等設備檢測

弱點掃描與修補作業

定期或適時辦理網路設備、伺服器及終端機的弱點掃描，並針對所發現之弱點進行改善、修補作業。評估弱點掃描作業之範圍、作業模式及弱點改善計畫與修補情形，針對掃描結果提出評估建議，重點在於找出架構中可能存在的弱點與漏洞，予以改善及修補，降低整體之資安風險。

4. 安全設定檢視

伺服器安全性原則設定

檢視伺服器(如：網域服務 Active Directory)有關「密碼設定原則」與「帳號鎖定原則」之設定，透過工具分析及人工作業，檢視相關網域安全性原則設定是否符合內控規範。

5. 網路詐騙防護 Internet Fraud Attack Protection

(1)透過不斷的宣導來提醒同仁注意網路詐騙訊息。

(2)實際的教育訓練來加強同仁對網路訊息的警覺心與辨識真假網路訊息的能力。

主要在於讓同仁瞭解電子郵件詐騙之風險，提高同仁防範社交工程詐騙之危機意識，以降低社交工程詐騙可能造成之風險與損失，進而達到保護客戶資料及重要營運資訊與服務之目的。

6. 資安事件通報與追蹤改善

本公司資安事故之通報與處理，皆有程序規範進行。

(1)同仁發現資安事件，向委員或申訴信箱舉報。

(2)資安事件應變小組，調查與確認資安事項，並出具改善措施與資安處理報告書。

(3)資安事件若情節重大且影響公司競爭力或財務狀況，需立即採取因應措施將損害降到最低。

有鑑於新型態的資安威脅，如勒索軟體、社交網路攻擊、電子郵件詐騙等威脅日益增多，透過調整及提升內外網路連線防護，落實備份，並定期安排弱點掃描與滲透測試，加強人員資安意識，全面提升資安防護能力。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃	長洛國際股份有限公司	108.01.01 ~ 108.12.31 (到期自動延長)	分租新竹縣新埔鎮文山路廠辦大樓及停車位	無
長期借款	彰化銀行-城內分行	108.11.08 ~ 118.10.15	土地及建築物抵押借款	無
長期借款	彰化銀行-城內分行	109.09.23 ~ 116.09.23	土地及建築物抵押借款	無
長期借款	彰化銀行-城內分行	110.11.09 ~ 120.10.15	土地及建築物抵押借款	無
長期借款	彰化銀行-城內分行	112.07.26 ~ 132.07.26	土地及建築物抵押借款	無
代理	長洛國際股份有限公司	100.01.01 ~ 未明訂 (若雙方未同意終止本契約，則視為繼續有效)	半導體相關設備之獨家代理銷售	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	9,505,177	6,904,126	2,601,051	37.67%
不動產、廠房及設備	4,561,432	3,390,814	1,170,618	34.52%
使用權資產	145,017	187,986	-42,969	-22.86%
無形資產	318,306	296,348	21,958	7.41%
遞延所得稅資產	165,252	163,430	1,822	1.11%
其他非流動資產	1,405,750	349,703	1,056,047	301.98%
資產總額	16,478,513	12,439,872	4,038,641	32.47%
流動負債	5,673,260	3,105,471	2,567,789	82.69%
非流動負債	1,498,303	1,713,902	-215,599	-12.58%
負債總額	7,171,563	4,819,373	2,352,190	48.81%
股本	942,311	942,311	0	0.00%
資本公積	1,744,545	1,744,545	0	0.00%
保留盈餘	6,543,703	4,936,727	1,606,976	32.55%
其他權益	72,171	-9,088	81,259	-894.14%
權益總額	9,306,950	7,620,499	1,686,451	22.13%

(一) 增減比例變動分析說明：(增減變動比例達20%以上且變動金額達新台幣一千萬元之分析)

- (1) 流動資產增加：係銀行存款、應收帳款及存貨增加所致。
- (2) 不動產、廠房及設備增加：係土地增加所致。
- (3) 使用權資產減少：係使用權資產續提折舊所致。
- (4) 其他非流動資產增加：係預付設備款增加所致。
- (5) 流動負債增加：係短期借款、預收貨款及應付設備款增加所致。
- (6) 保留盈餘增加：係本期淨利增加所致。
- (7) 其他權益減少：係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益減少所致。

(二) 未來因應計畫：本公司財務狀況良好，對股東權益尚無重大影響。

二、財務績效

(一)最近二年度經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入	10,171,861	8,147,112	2,024,749	24.85%
營業成本	4,610,891	4,250,049	360,842	8.49%
營業毛利	5,560,970	3,897,063	1,663,907	42.70%
營業費用	3,078,298	2,425,698	652,600	26.90%
營業淨利	2,482,672	1,471,365	1,011,307	68.73%
營業外收入及支出	312,044	110,930	201,114	181.30%
稅前淨利	2,794,716	1,582,295	1,212,421	76.62%
所得稅費用	490,471	263,747	226,724	85.96%
本期淨利	2,299,887	1,309,575	990,312	75.62%
本期其他綜合損益	93,297	76,549	16,748	21.88%
本期綜合損益總額	2,393,184	1,386,124	1,007,060	72.65%
(一)增減比例變動分析說明：(變動比率達20%以上之分析)				
(1)營業收入增加：主要因銷貨收入及買賣收入增加所致。				
(2)營業費用增加：主要受員工薪資、董監酬勞及研發技轉費用增加所致。				
(3)營業外收入及支出增加：主要因外幣兌換利益增加所致。				
(4)所得稅費用增加：主要因當期所得稅費用增加所致。				
(5)本期其他綜合損益增加：主要因國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				
(二)公司主要營業內容改變之原因，若營運政策、市場狀況、經濟環境或其他內外在因素已發生或預期將發生重大之變動，其事實及影響變動與對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。				
(三)預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：請參閱本年報「壹、致股東報告書」及「伍、營運概況」之說明。				

三、現金流量

(一)最近二年度現金流量變動之分析：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年	112 年	變動金額	增(減)比例(%)
營業活動	2,096,925	1,045,686	1,051,239	100.53%
投資活動	-1,343,097	-1,268,825	-74,272	5.85%
籌資活動	357,469	434,442	-76,973	-17.72%
合 計	1,111,297	211,303	899,994	425.93%
增減比例變動分析說明：(增減變動比例達 20%以上之分析)				
營業活動現金流入增加：主要因營收增加、應收帳款收現增加所致。				

(二) 最近二年度流動性分析：

年 度 項 目	113 年	112 年	增(減)比例(%)
現金流量比率	36.96	33.67	3.29
現金流量允當比率	115.29	113.36	1.93
現金再投資比率	10.82	3.74	7.08
增減比例變動分析說明:(增減變動比例達 20%以上之分析) 不適用。			

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額①	預計全年來自 營業活動淨現 金流量②	預計全年投資活 動暨融資活動現 金流入(出)量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
3,695,049	2,103,368	(1,772,495)	4,025,922	無	無
1. 本年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動現金流量:本公司營運持續成長，預計營業活動將有淨現金流入。 (2) 投資暨融資活動現金流量:因受到資本支出及發放現金股利影響，預計會呈淨現金流出。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司最近年度之轉投資政策均採保守穩健為原則，未有此情形。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

項 目	113 年度(仟元)	佔營收淨額%	佔稅後損益%
利息支出	30,627	0.30	1.33
淨兌換利益	150,220	1.48	6.53

(1)利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司113年度利息支出為新台幣30,627仟元，佔年度營收淨額0.30%及稅後損益1.33%。本公司會持續與銀行間維持良好關係以取得相對優惠之利率，並將隨時關注金融市場利率變化並適時調節資金部位，故預期未來利率之變化對本公司之整體營運尚無重大影響。

(2)匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司113年度淨兌換利益為新台幣150,220仟元，佔年度營收淨額1.48%及稅後損益6.53%。本公司因有外幣曝險部位，另受外銷產品至國外而有大量外幣應收帳款，然日常營運開銷因需以新台幣支應而有換匯需求，故匯率之變動將對本公司損益造成顯著影響，本公司將採取以下因應措施來規避匯兌風險：

- (a) 與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，持續蒐集影響外匯市場之相關資訊，期能充分掌握匯率趨勢，及時因應匯率波動之影響。
- (b) 除採自然避險方式，即以同幣別之銷貨收入支應採購支出規避匯率風險外，財會單位會密切關注外匯市場動態，並依全球總體經濟、匯率價格水準及未來資金需求等狀況，調整外幣部位，期以避免匯率波動對本公司之營運造成不利影響。
- (c) 本公司訂有「從事衍生性金融商品交易處理程序」與「取得或處份資產處理程序」，相關外匯交易將依循此二處理程序辦理之。

(3)通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司與供應商關係良好，所需之相關原物料價格仍屬穩定，並目前無通貨膨脹之情形。未來仍將致力於各項成本的降低，並關注原物料價格的變化適時採取相對應之措施。本公司截至年報刊印日止並未有因通貨膨脹而對營運造成不利影響之情事，故通貨膨脹對本公司無重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品交易等行為。所有交易皆依據本公司「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」所訂定之相關規定辦理外，並會依法辦理公告申報。

(三)未來年度研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司研發計畫皆以符合客戶需求為主，在最近年度研發計畫中已成功開發多項產品與技術，未來將持續投入研發與創新，2025年本公司預計將投入研發經費大約新台幣4億元，約佔營收的4%，以因應市場需求的快速變化。而影響公司研發是否成功之主要因素在於人才的徵選、留任及訓練等，因應新的技術挑戰，確保技術領先之地位。

未來預估進行之研發計畫：

研發計畫名稱	研發成功之主要因素	目前進度	未來需再投入經費	預計量產時程
3D封裝製程 Micro bump 測試方案	微機電結構設計能力	設計開發中	1.5 億	2026 年
高速(PAM4-448Gbps)垂直式探針卡	電性與結構設計能力	先期研究中	1.5 億	2026 年
通訊元件高頻光電訊號測試系統 (O/E & E/O test)	高頻光電訊號光耦合技術 高頻光電訊號量測迴路校正	開發驗證中	5,000 萬	2026 年

	高頻量測儀器整合 超低雜訊探針台系統 精密力量迴授高頻探針技術			
晶圓等級可靠度測試系統 (VCSEL, SiPh)	高精度晶圓探針台 晶圓等級探針卡製作技術 多通道電流源設計技術 高能量溫控系統	設計驗證中	3,000 萬	2025 年
矽光子封裝體光波導管特性量測系統	矽光子封裝體挑檢技術 高針數探針卡點測應用 高精度與高速光耦合技術 光波導管特性量測技術	設計驗證中	2,000 萬	2025 年

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均依照主管機關法令規定辦理，本公司亦會隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法規變動情形，評估其對公司之影響，並於事前採取相對應之措施，以規避因政策及法律變動可能造成的不利影響。本公司截至年報刊印日止，並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務受重大影響之情事。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：本公司為因應科技改變及產業變化，隨時掌握其市場變化，本公司透過參展、網路、產業、貿易及工會所舉辦的相關會議等方式獲取產業資訊訊息，並配合研發技術提昇及優異競爭優勢，擴展業務並精準掌握產業資訊之脈動，期以即時了解市場脈動並掌握獲利商機。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司企業形象良好，無此情形。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：因應未來營運及業務發展所需。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無此情形。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及年報刊印日止之處理情形：

因本公司離職員工於離職後至穎崙科技股份有限公司任職，涉嫌侵害本公司之營業秘密，經本公司提出刑事告訴，日前新竹地方檢察署起訴穎崙科技股份有限公司以及離職員工等人，該刑事案件目前由臺灣新竹地方法院審理中。

本公司對被告等人提起民事訴訟求償，已對上列當事人間侵害營業秘密有關財產權爭議等事件，本公司已向智慧財產法院及臺灣新竹地方法院聲請假扣押，累計已提存假扣押擔保金 80,550 千元，該營業秘密案經初步調查證據以及實施假扣押後，且因仍有相當多犯罪事證待刑事程序進行鑑識，該民事案件目前由臺灣高等法院及最高法院審理中。

本事件並不影響本公司之營運，且對本公司之財務亦無重大影響，另基於維護產業公平競爭以及捍衛智慧財產權之立場，本公司均已委任律師追訴相關被告之民事刑事法律責任。

截至民國 113 年 12 月 31 日及 112 年 12 月 31 日，本公司提存之假扣押擔保金金額分別為 80,550 元及 69,090 千元

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

(十四)行業特殊性的關鍵績效指標(Key Performance Indicator ,KPI):

本公司探針卡營運中心行業特性的關鍵績效指標為先進式探針卡技術之研發及其佔探針卡營收的比率，比率越高越好。以下為最近兩年度先進式探針卡佔探針卡營收比率一覽表：

產品技術項目	112 年	113 年
懸臂式探針卡	35%	29%
先進式探針卡	65%	71%

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

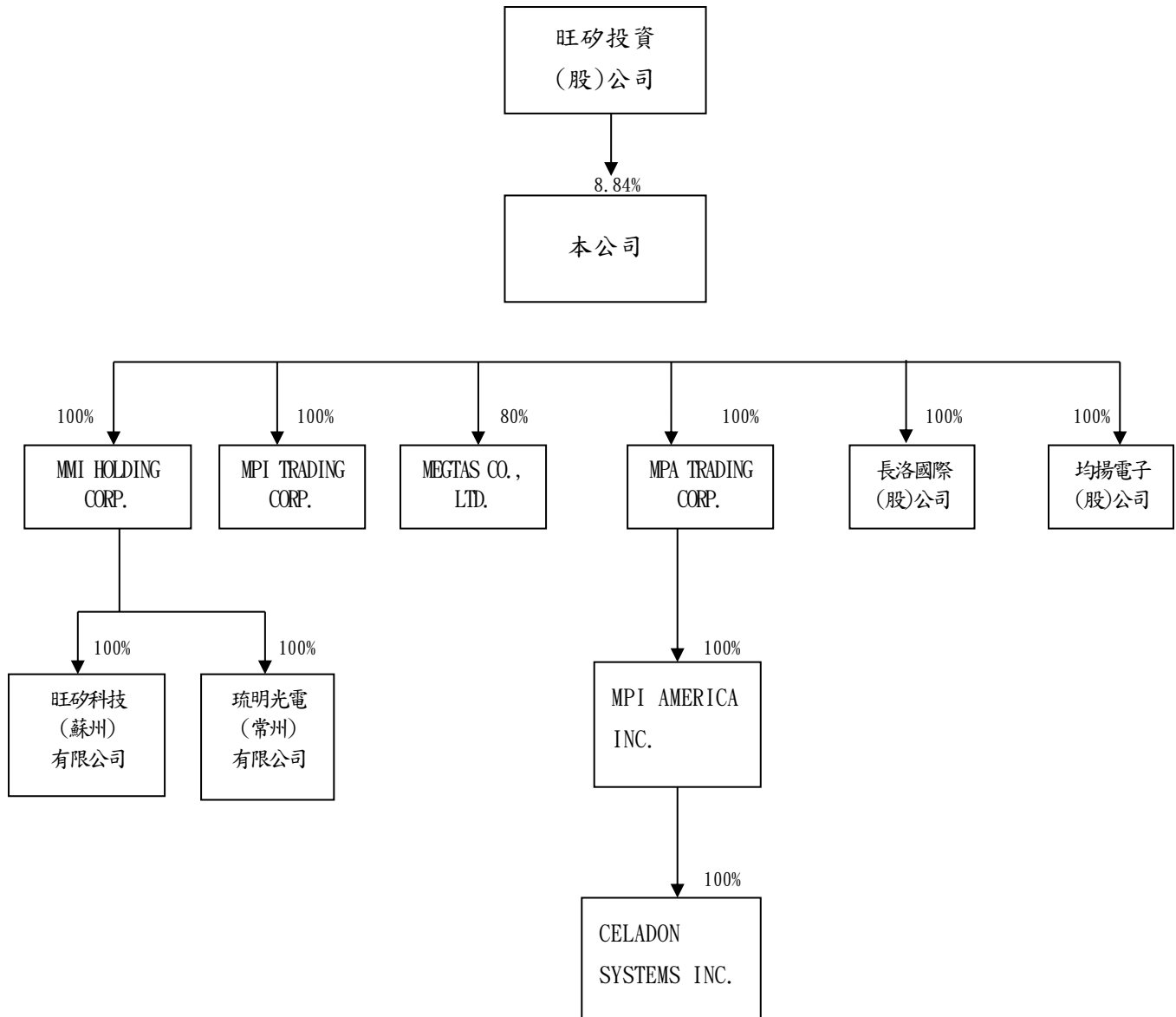
一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業合併營業報告書

1、關係企業概況

(1) 關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



(二)依公司法第 369 條之 2 規定之從屬公司，均編入關係企業合併財務報表。

(三)依公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係之公司：無。

二、各關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
旺矽投資股份有限公司	89.12.29	竹北市十興里 36 鄰嘉仁街 98 巷 8 號 3 樓	1,107	一般投資業
長洛國際股份有限公司	83.03.01	新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段 988 號 2 樓	50,000	半導體設備代理廠商
MPI TRADING CORP.	89.12.22	Offshore Chambers, P.O.BOX 217, APIA, SAMOA	1,000 美元	從事經營 Probe Card 探針卡業務
MMI HOLDING CO., LTD.	90.08.07	Offshore Chambers, P.O.BOX 217, APIA, SAMOA	18,267,987 美元	控股
MEGTAS CO., LTD.	99.09.01	134 Gunseo-ri, Jikson-eub, Seobuk-gu, Cheonan, Chungnam, 331-811, Korea	2,500,000,000 韓元	半導體裝備及產業機械零附件製造與加工販賣商、陶器及電子零附件製造與販賣商
均揚電子股份有限公司	95.03.31	新竹縣竹北市興安里 36 鄰嘉仁街 98 巷 8 號	15,500	高頻晶圓量測之探針製造商
MPATRADING CORP.	106.04.12	Vistra (Anguilla) Limited of Vistra Corporate Services Centre, Albert Lake Drive, The Valley, Anguilla, British West Indies.	11,450,000 美元	控股
琉明光電(常州)有限公司	103.01.10	武進國家高新技術產業開發區武宜南路 377 號	16,000,000 美元	研發、生產 LED 半導體照明芯片、計算機零附件、LED 製程設備、新型電子元器件；電子材料、電子元器件、電子產品、LED 製程設備、機械設備及零部件的國內採購、批發、佣金代理和進出口業務。
旺矽科技(蘇州)有限公司	106.07.11	蘇州工業園區春輝路 13 號	2,000,000 美元	研發、生產 LED 半導體照明芯片、計算機零附件、LED 製程設備、新型電子元器件；電子材料、電子元器件、電子產品、LED 製程設備、機械設備及零部件的採購、批發、佣金代理及進出口業務。

MPI AMERICA INC.	106.03.29	2360 QUME DRIVE, SUITE C, SAN JOSE, CA	11,400,000 美元	從事探針卡及半自動點測機買賣
CELADON SYSTEMS INC.	85.05.17	13795 FRONTIER CT BURNSVILLE, MINNESOTA 55337, USA	2,255,106 美元	探針卡及測試系統、高性能電纜之產銷

三、推定為有控制與從屬關係者應揭露事項：無。

四、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：投資業；半導體設備及零附件之生產、測試、研發、製造及買賣；半導體設備代理；貿易業務；電子資訊供應服務；電子器材、電子材料批發零售及電子零組件製造等。

五、各關係企業董事、監察人及總經理資料：

113 年 12 月 31 日

企業名稱	職 稱(註 1)	姓名或代表人	持有股份(註 2)(註 3)	
			股 數 (出資額)	持股比例 (出資比例)
旺矽投資(股)公司	董事長	葛長林	49,636 股	44.83%
	董事	李篤誠	30,089 股	27.17%
	董事	陳四桂	10,029 股	9.06%
	監察人	郭遠明	2,966 股	2.68%
長洛國際(股)公司	出資者名稱	旺矽科技(股)公司	5,000,000 股	100.00%
	董事長	葛長林		
	董事	陳四桂		
	董事	郭遠明		
	監察人	饒雲珍		
	總經理	詹朝男		
MPI TRADING CORP.	出資者名稱	旺矽科技(股)公司	1,000 股	100.00%
	負責人	葛長林		
MMI HOLDING CO., LTD.	出資者名稱	旺矽科技(股)公司	18,267,987 股	100.00%
	負責人	葛長林		

MEGTAS CO., LTD.	出資者名稱	旺矽科技(股)公司	400,000 股	80.00%
	出資者名稱	LUCID DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD	100,000 股	20.00%
	董事長	HUAN-SHENG LIN		
	董事	HUAN-SHENG LIN		
	董事	DU-HWA HWANG		
	董事	JUNG-JAE CHEUN		
	監察人	SHENG-YI CHEN		
均揚電子(股)公司	出資者名稱	旺矽科技(股)公司	1,550,000 股	100.00%
	代表人：			
	董事長	郭遠明		
	董事	陳四桂		
	董事	劉永欽		
	監察人	饒雲珍		
MPA TRADING CORP.	出資者名稱	旺矽科技(股)公司	11,450,000 股	100.00%
	負責人	葛長林		
琉明光電(常州)有限公司	出資者名稱	MMI HOLDING CO., LTD.	16,000,000 美元	100.00%
	負責人	郭遠明		
旺矽科技(蘇州)有限公司	出資者名稱	MMI HOLDING CO., LTD.	2,000,000 美元	100.00%
	負責人	詹雲富		
MPI AMERICA INC.	出資者名稱	MPA TRADING CORP.	6,300,000 股	100.00%
	負責人	Robert S. Carter		
CELADON SYSTEMS INC.	出資者名稱	MPI AMERICA INC.	1,000 股	100.00%
	負責人	Karen R. Armendariz		

註 1. 關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註 2. 被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註 3. 董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

註 4. 以上各關係企業未設總經理者，以各該企業之董事長(或負責人、董事)兼任之。

貳、關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
長洛國際 (股)公司	50,000	723,945	474,202	249,743	480,158	15,921	25,953	5.19
MPI TRADING CORP.	32	59,115	—	59,115	—	(41)	(1,987)	(1,987)
MMI HOLDING CO., LTD.	573,502	995,872	—	995,872	110,504	110,469	111,317	6.09
MEGTAS CO., LTD.	66,509	42,241	21,138	21,103	41,637	(7,686)	(7,361)	(14.72)
均揚電子 (股)公司	15,500	749	20	729	—	(369)	(361)	(0.23)
MPA TRADING CORP.	321,352	164,434	—	164,434	107,457	107,400	107,486	9.39
琉明光電(常 州)有限公司	502,470	639,183	29,746	609,437	164,254	(22,484)	(8,356)	—
旺矽科技(蘇 州)有限公司	60,180	1,361,542	988,726	372,816	2,684,050	118,681	118,715	—
MPI AMERICA INC.	319,837	1,601,792	1,438,674	163,118	2,327,419	102,233	107,442	17.05
CELADON SYSTEMS INC.	62,793	190,945	28,406	162,539	281,677	24,047	24,412	24,412

註 1. 所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註 2. 關係企業如為外國公司，相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

註 3. 以上關係企業財務報表業經母公司會計師查核簽證。

註 4. 若被投資公司為有限公司，其每股盈餘不適用。

註 5. 報表日兌換率：人民幣：台幣=1：4.48205；加權平均匯率：1：4.41739

新台幣：美金=1：32.79325；加權平均匯率：1：31.7475

新台幣：韓元=1：0.02249；加權平均匯率：1：0.0232

(二) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：旺矽科技股份有限公司



董 事 長：葛 長 林



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日

(三) 關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

旺矽科技股份有限公司



董事長：葛長林

